

股票代碼：5425

台灣半導體股份有限公司
個體財務報告暨會計師查核報告
民國一一三年度及一一二年度

公司地址：新北市新店區北新路三段205號11樓
電話：(02)89131588

目 錄

項 目	頁 次
一、封 面	1
二、目 錄	2
三、會計師查核報告書	3
四、資產負債表	4
五、綜合損益表	5
六、權益變動表	6
七、現金流量表	7
八、個體財務報告附註	
(一)公司沿革	8
(二)通過財務報告之日期及程序	8
(三)新發布及修訂準則及解釋之適用	8~9
(四)重大會計政策之彙總說明	10~20
(五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	20
(六)重要會計項目之說明	21~44
(七)關係人交易	45~48
(八)質押之資產	48
(九)重大或有負債及未認列之合約承諾	48
(十)重大之災害損失	48
(十一)重大之期後事項	48
(十二)其 他	49
(十三)附註揭露事項	
1.重大交易事項相關資訊	50~52
2.轉投資事業相關資訊	52~53
3.大陸投資資訊	54
4.主要股東資訊	54
(十四)部門資訊	54
九、重要會計項目明細表	55~67



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666
傳真 Fax + 886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

台灣半導體股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

台灣半導體股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請參閱其他事項段），上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台灣半導體股份有限公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台灣半導體股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

其他事項

列入台灣半導體股份有限公司採用權益法之投資中，有關鼎翰科技股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關鼎翰科技股份有限公司財務報告所認列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一三年及一一二年十二月三十一日對鼎翰科技股份有限公司採用權益法之投資金額分別占資產總額之10.49%及10.67%，民國一一三年及一一二年一月一日至十二月三十一日對其採用權益法認列之子公司利益份額分別占稅前淨利之39.31%及31.95%。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台灣半導體股份有限公司民國一一三年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)收入之認列；收入之說明請詳個體財務報告附註六(十五)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

台灣半導體股份有限公司主要營業項目為整流器之製造及買賣業務，收入認列為本會計師執行該公司財務報告查核重要評估事項。銷貨收入係投資人及管理階層評估公司績效之主要指標，故收入認列之合理性為本會計師執行查核重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序，包括測試銷貨及收款作業循環之相關控制，以確定收入紀錄可靠性；並針對銷售系統資料與總帳分錄進行核對及調節，及評估銷售條件與會計政策認列之一致性；另針對前十大銷售客戶進行趨勢分析，以評估是否有重大異常；使用系統工具抽樣測試年度結束前後期間銷售交易，以評估收入認列期間及金額之正確性。

二、採用權益法之投資減損評估

有關採用權益法之投資之會計政策請詳個體財務報告附註四(八)投資子公司及(十二)非金融資產減損；採用權益法之投資之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五(三)採用權益法之投資減損評估；採用權益法之投資之說明，請詳個體財務報告附註六(五)採用權益法之投資。

關鍵查核事項之說明：

台灣半導體股份有限公司採用權益法之投資中，鼎翰科技股份有限公司(鼎翰科技)於企業合併取得業務及控制權時，於合併財務報告認列商譽，該等金額對財務報告係屬重大，此外，衡量商譽是否減損，有賴對現金產生單位未來現金流量之估計以決定可回收金額，未來現金流量之估計涉及產業狀況及未來營運成果等之預估，該等預估情況一旦改變，將影響可回收金額而產生減損。因該等採用權益法之投資係台灣半導體股份有限公司之重要轉投資且該帳面金額對個體財務報告係屬重大，因此，本會計師認為台灣半導體股份有限公司對該等採用權益法之投資所作之減損評估，為本年度查核重要事項評估之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括與其他會計師進行溝通，對其他會計師發出查核指示函，並取得經其他會計師對鼎翰科技執行查核後之查核報告。

其他會計師針對商譽之查核程序則包括取得鼎翰科技管理階層委任之評價專家所出具之商譽價值減損測試評估報告，瞭解並評估其評價模型所計算可回收金額之合理性；並對評價模型所使用之假設包括銷售成長率、利潤率、加權平均資金成本(包括無風險報酬利率及風險貼水報酬)等，考量公司過去營運狀況、所屬產業情況及未來展望等，綜合評估上述商譽減損評估之合理性。

本會計師亦比較採用權益法之投資帳面金額及鼎翰科技財務報告中所揭露之其淨資產餘額差異（依台灣半導體股份有限公司持有之所有權份額）並觀察鼎翰科技於證券市場之價格。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估台灣半導體股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台灣半導體股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台灣半導體股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台灣半導體股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
- 4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台灣半導體股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台灣半導體股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
- 5.評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成台灣半導體股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台灣半導體股份有限公司民國一一三年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

郭仰倫



會計師：

蕭佩如



證券主管機關：金管證審字第1120333238號

核准簽證文號：金管證審字第1040003949號

民國一一四年三月十四日

台灣半導體股份有限公司

綜合損益表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(十五)及七)	\$ 4,295,553	102	4,708,842	102
4190 減：銷貨退回及折讓	98,547	2	98,369	2
營業收入淨額	4,197,006	100	4,610,473	100
5000 營業成本(附註六(四)及七)	3,489,795	83	3,506,778	76
營業毛利	707,211	17	1,103,695	24
5910 減：未實現銷貨(損)益	354	-	(15,662)	-
	706,857	17	1,119,357	24
6000 營業費用(附註六(十二)、(十七)及七)：				
6100 推銷費用	351,858	8	354,097	7
6200 管理費用	198,054	5	215,950	5
6300 研究發展費用	126,066	3	141,341	3
6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(三))	151	-	(7,803)	-
	676,129	16	703,585	15
營業淨利	30,728	1	415,772	9
營業外收益及費損(附註六(十六)及七)：				
7100 利息收入	5,476	-	11,614	-
7010 其他收入	15,649	-	19,311	-
7020 其他利益及損失	84,863	2	36,031	1
7050 財務成本	(24,400)	-	(22,675)	-
7070 採用權益法認列子公司利益之份額(附註六(五))	419,887	10	404,836	9
	501,475	12	449,117	10
稅前淨利	532,203	13	864,889	19
7950 減：所得稅費用(附註六(十三))	68,352	2	146,249	3
本期淨利	463,851	11	718,640	16
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十二))	1,328	-	(2,775)	-
8330 採用權益法認列之子公司之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目	(3,999)	-	(651)	-
	(2,671)	-	(3,426)	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	174,852	4	(59,972)	(1)
	174,852	4	(59,972)	(1)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)	172,181	4	(63,398)	(1)
本期綜合損益總額	\$ 636,032	15	\$ 655,242	15
基本每股盈餘(元)(附註六(十八))	\$ 1.87		\$ 2.89	
稀釋每股盈餘(元)(附註六(十八))	\$ 1.87		\$ 2.88	

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭



會計主管：鄭懿誠



台灣手導膠股份有限公司

權益變動表

民國一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘			合計	其他權益項目	庫藏股票	權益總額
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘		國外營運 機構財務報表 換算之兌換 差額		
民國一一年一月一日餘額	\$ 2,634,854	2,137,088	973,024	531,125	2,651,442	4,155,591	(359,558)	(506,043)	8,061,932
本期淨利	-	-	-	-	718,640	718,640	-	-	718,640
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,426)	(3,426)	(59,972)	-	(63,398)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	715,214	715,214	(59,972)	-	655,242
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	156,719	-	(156,719)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(1,053,942)	(1,053,942)	-	-	(1,053,942)
發放予子公司股利調整資本公積	-	59,200	-	-	-	-	-	-	59,200
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	12,963	-	-	-	-	-	-	12,963
民國一一年十二月三十一日餘額	2,634,854	2,209,251	1,129,743	531,125	2,155,995	3,816,863	(419,530)	(506,043)	7,735,395
本期淨利	-	-	-	-	463,851	463,851	-	-	463,851
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(2,671)	(2,671)	174,852	-	172,181
本期綜合損益總額	-	-	-	-	461,180	461,180	174,852	-	636,032
子公司購入母公司之股票視為庫藏股票	-	-	-	-	-	-	-	(93,835)	(93,835)
盈餘指撥及分配：									
提列法定盈餘公積	-	-	71,521	-	(71,521)	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(526,971)	(526,971)	-	-	(526,971)
發放予子公司股利調整資本公積	-	31,920	-	-	-	-	-	-	31,920
採用權益法認列之關聯企業之變動數	-	11,813	-	-	-	-	-	-	11,813
民國一一年十二月三十一日餘額	\$ 2,634,854	2,252,984	1,201,264	531,125	2,018,683	3,751,072	(244,678)	(599,878)	7,794,354

董事長：王秀亭



經理人：王秀亭

(請詳閱後附個體財務報告附註)



~6~

會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司

現金流量表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 532,203	864,889
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	371,455	333,878
攤銷費用	35,853	51,927
預期信用減損損失(迴轉利益)	151	(7,803)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益	(9,430)	(3,169)
利息費用	23,247	21,285
利息收入	(5,476)	(11,614)
採用權益法認列之子公司利益之份額	(419,887)	(404,836)
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	(746)	(99)
其他	354	(15,662)
收益費損項目合計	(4,479)	(36,093)
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	1,636	(16,918)
應收票據(增加)減少	270	(230)
應收帳款(增加)減少	(55,164)	190,174
應收帳款－關係人(增加)減少	(84,143)	227,966
其他應收款減少	1,064	5,230
存貨(增加)減少	140,556	(30,395)
其他流動資產(增加)減少	(41,699)	76,848
應付帳款減少	(12,247)	(219,263)
應付帳款－關係人增加(減少)	19,857	(35,392)
其他應付款增加(減少)	605	(252)
其他應付款－關係人增加(減少)	8,367	(2,951)
其他流動負債增加(減少)	5,545	(93,459)
淨確定福利負債減少	(15,563)	(328)
調整項目合計	(35,395)	64,937
營運產生之現金流入	496,808	929,826
收取之利息	5,478	12,071
收取之股利	560,165	333,180
支付之利息	(25,614)	(22,432)
支付之所得稅	(117,273)	(300,972)
營業活動之淨現金流入	919,564	951,673
投資活動之現金流量：		
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(34,145)	(19,607)
取得不動產、廠房及設備	(115,047)	(105,072)
處分不動產、廠房及設備	1,101	-
取得使用權資產	-	(2,035)
取得無形資產	(9,092)	(59,233)
其他非流動資產減少	66,361	70,878
預付設備款增加	(252,819)	(226,692)
投資活動之淨現金流出	(343,641)	(341,761)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(504,935)	360,000
舉借長期借款	522,550	-
償還長期借款	(298,583)	(259,349)
租賃本金償還	(971)	(567)
發放現金股利	(526,971)	(1,053,942)
籌資活動之淨現金流出	(808,910)	(953,858)
本期現金及約當現金減少數	(232,987)	(343,946)
期初現金及約當現金餘額	795,597	1,139,543
期末現金及約當現金餘額	\$ 562,610	795,597

董事長：王秀亭



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：王秀亭

~7~



會計主管：鄭懿誠



台灣半導體股份有限公司
個體財務報告附註
民國一一三年度及一一二年度
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

台灣半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國六十八年一月依中華民國公司法設立，註冊地址為新北市新店區北新路3段205號11樓。本公司股票於民國八十九年二月在中華民國證券櫃檯買賣中心(以下稱「櫃買中心」)掛牌交易。

本公司為透過業務及組織重組，朝向專業分工，以提升企業經營效率及產業競爭力，將條碼印表機事業處以新設分割方式，分割予新設之鼎翰科技股份有限公司(以下稱「鼎翰科技」)；經董事會決議訂定分割基準日為民國九十六年八月一日。

本公司主要營業項目為整流器之製造及買賣業務。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告已於民國一一四年三月十四日經董事會通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

本公司自民國一一三年一月一日起開始適用下列新修正之國際財務報導準則會計準則，且對個體財務報告未造成重大影響。

- 國際會計準則第1號之修正「負債分類為流動或非流動」
- 國際會計準則第1號之修正「具合約條款之非流動負債」
- 國際會計準則第7號及國際財務報導準則第7號之修正「供應商融資安排」
- 國際財務報導準則第16號之修正「售後租回中之租賃負債」

(二)尚未採用金管會認可之國際財務報導準則會計準則之影響

本公司評估適用下列自民國一一四年一月一日起生效之新修正之國際財務報導準則會計準則，將不致對個體財務報告造成重大影響。

- 國際會計準則第21號之修正「缺乏可兌換性」

(三)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

國際會計準則理事會已發布及修正但尚未經金管會認可之準則及解釋，對本公司可能攸關者如下：

新發布或修訂準則
國際財務報導準則第18號
「財務報表之表達與揭露」

主要修訂內容
新準則引入三種類收益及費損、兩項損益表小計及一項關於管理階層績效衡量的單一附註。此等三項修正與強化在財務報表中如何對資訊細分之指引，為使用者提供更佳及更一致的資訊奠定基礎，並將影響所有公司。

**理事會發布之
生效日**
2027年1月1日

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

新發布或修訂準則	主要修訂內容	理事會發布之生效日
國際財務報導準則第18號「財務報表之表達與揭露」	<ul style="list-style-type: none"> • 更具結構化之損益表：根據現行準則，公司使用不同的格式來表達其經營成果，使投資者難以比較不同公司間的財務績效。新準則採用更具結構化的損益表，引入新定義之「營業利益」小計，並規定所有收益及費損，將依公司主要經營活動歸類於三個新的不同種類。 • 管理階層績效衡量(MPM)：新準則引入管理階層績效衡量之定義，並要求公司於財務報表之單一附註中，對於每一衡量指標解釋其為何可提供有用之資訊、如何計算及如何將衡量指標與根據國際財務報導準則會計準則所認列的金額進行調節。 • 較細分之資訊：新準則包括公司如何於財務報表強化對資訊分組之指引。此包括資訊是否應列入主要財務報表或於附註中進一步細分之指引。 	2027年1月1日

本公司現正持續評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

本公司預期下列其他尚未認可之新發布及修正準則不致對個體財務報告造成重大影響。

- 國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」
- 國際財務報導準則第17號「保險合約」及國際財務報導準則第17號之修正
- 國際財務報導準則第19號「不具公共課責性之子公司：揭露」
- 國際財務報導準則第9號及國際財務報導準則第7號之修正「金融工具之分類與衡量之修正」
- 國際財務報導準則會計準則之年度改善
- 國際財務報導準則第9號及國際財務報導準則第7號之修正「仰賴大自然電力合約」

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

四、重大會計政策之彙總說明

本個體財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下，下列會計政策已一致適用於本個體財務報告之所有表達期間。

(一) 遵循聲明

本個體財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下稱「編製準則」)編製。

(二) 編製基礎

1. 衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本個體財務報告係依歷史成本為基礎編製：

- (1) 依公允價值衡量之透過損益按公允價值衡量金融資產；
- (2) 依公允價值衡量之透過其他綜合損益按公允價值金融資產；
- (3) 淨確定福利負債，係依確定福利義務現值，減除計畫資產公允價值之淨額認列。

2. 功能性貨幣及表達貨幣

本公司係以營運所處主要經濟環境之貨幣為其功能性貨幣。本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣，新台幣為表達貨幣。所有以新台幣表達之財務資訊除另有註明者外，均以新台幣千元為單位。

(三) 外幣

1. 外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。於後續每一報導期間結束日(以下稱報導日)之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。

換算所產生之外幣兌換差異通常係認列於損益，惟以下情況係認列於其他綜合損益：

- (1) 指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具；
- (2) 指定為國外營運機構淨投資避險之金融負債於避險有效範圍內；或
- (3) 合格之現金流量避險於避險有效範圍內。

2. 國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，係依據報導日之匯率換算為本個體財務報告之表達貨幣；收益及費損項目則依當期平均匯率換算為本個體財務報告之表達貨幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(四)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

本公司對符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於其正常營業週期中實現該資產，或意圖將其出售或消耗；
- 2.主要為交易目的而持有該資產；
- 3.預期於報導期間後十二個月內實現該資產；或
- 4.該資產為現金或約當現金(如國際會計準則第7號所定義)，除非於報導期間後至少十二個月將該資產交換或用以清償負債受到限制。

本公司對符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

- 1.預期將於正常營業週期中清償該負債；
- 2.主要為交易目的而持有該負債；
- 3.該負債於報導期間後十二個月內到期清償；或
- 4.於報導期間結束日不具有將該負債之清償遞延至報導期間後至少十二個月之權利。

(五)現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(六)金融工具

應收帳款及所發行之債務證券原始係於產生時認列。所有其他金融資產及金融負債原始係於本公司成為金融工具合約條款之一方時認列。非透過損益按公允價值衡量之金融資產(除不包含重大財務組成部分之應收帳款外)或金融負債原始係按公允價值加計直接可歸屬於該取得或發行之交易成本衡量。不包含重大財務組成部分之應收帳款原始係按交易價格衡量。

1.金融資產

金融資產之購買或出售符合慣例交易者，本公司對以相同方式分類之金融資產，其所有購買及出售一致地採交易日會計處理。

原始認列時金融資產分類為：按攤銷後成本衡量之金融資產、透過損益按公允價值衡量之金融資產。

本公司僅於改變管理金融資產之經營模式時，始自下一個報導期間之首日起重新分類所有受影響之金融資產。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(1)按攤銷後成本衡量之金融資產

金融資產同時符合下列條件，且未指定為透過損益按公允價值衡量時，係按攤銷後成本衡量：

- 係在以收取合約現金流量為目的之經營模式下持有該金融資產。
- 該金融資產之合約條款產生特定日期之現金流量，完全為支付本金及流通在外本金金額之利息。

該等資產後續以原始認列金額加減計採有效利息法計算之累積攤銷數，並調整任何備抵損失之攤銷後成本衡量。利息收入、外幣兌換損益及減損損失係認列於損益。除列時，將利益或損失列入損益。

(2)透過損益按公允價值衡量之金融資產

非屬按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，係透過損益按公允價值衡量，包括衍生金融資產。本公司於原始認列時，為消除或重大減少會計配比不當，得不可撤銷地將符合按攤銷後成本衡量或透過其他綜合損益按公允價值衡量條件之金融資產，指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產。

該等資產後續按公允價值衡量，其淨利益或損失(包含任何股利及利息收入)係認列為損益。

(3)金融資產減損

本公司針對按攤銷後成本衡量之金融資產(包括現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之金融資產、應收票據及應收帳款、其他應收款、存出保證金及其他金融資產等)及合約資產之預期信用損失認列備抵損失。

下列金融資產係按十二個月預期信用損失金額衡量備抵損失，其餘係按存續期間預期信用損失金額衡量：

- 判定債務證券於報導日之信用風險低；及
- 其他債務證券及銀行存款之信用風險(即金融工具之預期存續期間發生違約之風險)自原始認列後未顯著增加。

應收帳款及合約資產之備抵損失係按存續期間預期信用損失金額衡量。

於判定自原始認列後信用風險是否已顯著增加時，本公司考量合理且可佐證之資訊(無需過度成本或投入即可取得)，包括質性及量化資訊，及根據本公司之歷史經驗、信用評估及前瞻性資訊所作之分析。

若合約款項逾期超過90天，本公司假設金融資產之信用風險已顯著增加。

若合約款項逾期超過365天，或債務人不太可能履行其信用義務支付全額款項予本公司時，本公司視為該金融資產發生違約。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

預期信用損失為金融工具預期存續期間信用損失之機率加權估計值。信用損失係按所有現金短收之現值衡量，亦即本公司依據合約可收取之現金流量與本公司預期收取之現金流量之差額。預期信用損失係按金融資產之有效利率折現。

於每一報導日本公司評估按攤銷後成本衡量金融資產及透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務證券是否有信用減損。對金融資產之估計未來現金流量具有不利影響之一項或多項事項已發生時，該金融資產已信用減損。金融資產已信用減損之證據包括有關下列事項之可觀察資料：

- 借款人或發行人之重大財務困難；
- 違約，諸如延滯或逾期超過365天；
- 因與借款人之財務困難相關之經濟或合約理由，本公司給予借款人原本不會考量之讓步；
- 借款人很有可能聲請破產或進行其他財務重整；或
- 由於財務困難而使該金融資產之活絡市場消失。

按攤銷後成本衡量之金融資產之備抵損失係自資產之帳面金額中扣除。透過其他綜合損益按公允價值衡量債務工具投資之備抵損失係調整損益及認列於其他綜合損益(而不減少資產之帳面金額)。

當本公司對回收金融資產整體或部分無法合理預期時，係直接減少其金融資產總帳面金額。對公司戶，本公司係以是否合理預期可回收之基礎個別分析沖銷之時點及金額。本公司預期已沖銷金額將不會重大迴轉。然而，已沖銷之金融資產仍可強制執行，以符合本公司回收逾期金額之程序。

(4)金融資產之除列

本公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產所有權之幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，或既未移轉亦未保留所有權之幾乎所有風險及報酬且未保留該金融資產之控制時，始將金融資產除列。

本公司簽訂移轉金融資產之交易，若保留已移轉資產所有權之所有或幾乎所有風險及報酬，則仍持續認列於資產負債表。

2.金融負債及權益工具

(1)負債或權益之分類

本公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

(2)權益交易

權益工具係指表彰本公司於資產減除其所有負債後剩餘權益之任何合約。本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(3)庫藏股票

再買回本公司已認列之權益工具時，係將所支付之對價(包括可直歸屬成本)認列為權益之減少。再買回之股份係分類為庫藏股票。後續出售或再發行庫藏股票，所收取之金額係認列為權益之增加，並將該交易所產生之剩餘或虧損認列為資本公積或保留盈餘(若資本公積不足沖抵)。

(4)金融負債

金融負債係分類為攤銷後成本或透過損益按公允價值衡量。金融負債若屬持有供交易、衍生工具或於原始認列時指定，則分類為透過損益按公允價值衡量。透過損益按公允價值衡量之金融負債係以公允價值衡量，且相關淨利益及損失，包括任何利息費用，係認列於損益。

其他金融負債後續採有效利息法按攤銷後成本衡量。利息費用及兌換損益係認列於損益。除列時之任何利益或損失亦係認列於損益。

(5)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於本公司目前有法律上可執行之權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

3.衍生金融工具

本公司為規避外幣及利率風險之暴險而持有衍生金融工具。嵌入式衍生工具於符合特定條件且該主合約非屬金融資產時，其與主合約分離處理。衍生工具原始認列時係按公允價值衡量；後續依公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失直接列入損益。

(七)存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用的地點及狀態所發生之取得、產製或加工成本及其他成本，並採先進先出法計算。製成品及在製品存貨之成本包括依適當比例按正常產能分攤之製造費用。

淨變現價值係指正常營業下之估計售價減除估計完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

(八)投資子公司

於編製個體財務報告時，本公司對具控制力之被投資公司係採權益法評價。在權益法下，個體財務報告當期損益及其他綜合損益與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬於母公司業主之分攤數相同，且個體財務報告業主權益與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。

本公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制者，作為與業主間之權益交易處理。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(九)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備項目係依成本(包括資本化之借款成本)減累計折舊及任何累計減損衡量。

不動產、廠房及設備之重大組成部分耐用年限不同時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分利益或損失係認列於損益。

2.後續成本

後續支出僅於其未來經濟效益很有可能流入本公司時始予以資本化。

3.折 舊

折舊係依資產成本減除殘值計算，並採直線法於每一組成部分之估計耐用年限內認列於損益。

土地不予提列折舊。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

(1)房屋及建築：4~56年

(2)機器設備：4~15年

(3)運輸設備：7年

(4)辦公及其他設備：1~11年

本公司於每一報導日檢視折舊方法、耐用年限及殘值，並於必要時適當調整。

(十)租 賃

本公司係於合約成立日評估合約是否係屬或包含租賃，若合約轉讓對已辨認資產之使用之控制權一段時間以換得對價，則合約係屬或包含租賃。

1.承租人

本公司於租賃開始日認列使用權資產及租賃負債，使用權資產係以成本為原始衡量，該成本包含租賃負債之原始衡量金額，調整租賃開始日或之前支付之任何租賃給付，並加計所發生之原始直接成本及為拆卸、移除標的資產及復原其所在地點或標的資產之估計成本，同時減除收取之任何租賃誘因。

使用權資產後續於租賃開始日至使用權資產之耐用年限屆滿時或租賃期間屆滿時兩者之較早者以直線法提列折舊。此外，本公司定期評估使用權資產是否發生減損並處理任何已發生之減損損失，並於租賃負債發生再衡量的情況下配合調整使用權資產。

租賃負債係以租賃開始日尚未支付之租賃給付之現值為原始衡量。若租賃隱含利率容易確定，則折現率為該利率，若並非容易確定，則使用本公司之增額借款利率。一般而言，本公司係採用其增額借款利率為折現率。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

計入租賃負債衡量之租賃給付包括：

- (1) 固定給付，包括實質固定給付；
- (2) 取決於某項指數或費率之變動租賃給付，採用租賃開始日之指數或費率為原始衡量；
- (3) 預期支付之殘值保證金額；及
- (4) 於合理確定將行使購買選擇權或租賃終止選擇權時之行使價格或所須支付之罰款。

租賃負債後續係以有效利息法計提利息，並於發生以下情況時再衡量其金額：

- (1) 用以決定租賃給付之指數或費率變動導致未來租賃給付有變動；
- (2) 預期支付之殘值保證金額有變動；
- (3) 標的資產購買選擇權之評估有變動；
- (4) 對是否行使延長或終止選擇權之估計有所變動，而更改對租賃期間之評估；
- (5) 租賃標的、範圍或其他條款之修改。

租賃負債因前述用以決定租賃給付之指數或費率變動、殘值保證金額有變動以及購買、延長或終止選擇權之評估變動而再衡量時，係相對應調整使用權資產之帳面金額，並於使用權資產之帳面金額減至零時，將剩餘之再衡量金額認列於損益中。

對於減少租賃範圍之租賃修改，則係減少使用權資產之帳面金額以反映租賃之部分或全面終止，並將其與租賃負債再衡量金額間之差額則認列於損益中。

本公司將不符合投資性不動產定義之使用權資產及租賃負債分別以單行項目表達於資產負債表中。

針對運輸設備及辦公設備等租賃之短期租賃及低價值標的資產租賃，本公司選擇不認列使用權資產及租賃負債，而係將相關租賃給付依直線基礎於租賃期間內認列為費用。

2. 出租人

本公司為出租人之交易，係於租賃成立日將租賃合約依其是否移轉附屬於標的資產所有權之幾乎所有風險與報酬分類，若是則分類為融資租賃，否則分類為營業租賃。於評估時，本公司考量包括租賃期間是否涵蓋標的資產經濟年限之主要部分等相關特定指標。

若本公司為轉租出租人，則係分別處理主租賃及轉租交易，並以主租賃所產生之使用權資產評估轉租交易之分類。若主租賃為短期租賃並適用認列豁免，則應將其轉租交易分類為營業租賃。

若協議包含租賃及非租賃組成部分，本公司使用國際財務報導準則第15號之規定分攤合約中之對價。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

融資租賃下所持有之資產，以租賃投資淨額之金額表達為應收融資租賃款。因協商與安排營業租賃所產生之原始直接成本，包含於租賃投資淨額內。租賃投資淨額係以能反映在各期間有固定報酬率之型態，於租賃期間分攤認列為利息收入。針對營業租賃，本公司採直線基礎將所收取之租賃給付於租賃期間內認列為租金收入。

(十一)無形資產

本公司取得其他無形資產係以成本減除累計攤銷與累計減損衡量之。後續支出僅於可增加相關特定資產的未來經濟效益時，方可將其資本化。攤銷時係以資產成本減除殘值後金額為可攤銷金額。無形資產耐用年限如下：

電腦軟體：1~7年

本公司至少於每一年度報導日檢視無形資產之殘值、攤銷期間及攤銷方法，若有變動，視為會計估計變動。

(十二)非金融資產減損

本公司於每一報導日評估是否有跡象顯示非金融資產之帳面金額可能有減損。若有任一跡象存在，則估計該資產之可回收金額。

為減損測試之目的，係將現金流入大部分獨立於其他個別資產或資產群組之現金流入之一組資產作為最小可辨認資產群組。

可回收金額為個別資產或現金產生單位之公允價值減處分成本與其使用價值孰高者。於評估使用價值時，估計未來現金流量係以稅前折現率折算至現值，該折現率應反映現時市場對貨幣時間價值及對該資產或現金產生單位特定風險之評估。

個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於帳面金額，則認列減損損失。減損損失係立即認列於損益。

(十三)收入之認列

1.客戶合約之收入

收入係按移轉商品或勞務而預期有權取得之對價衡量。本公司係於對商品或勞務之控制移轉予客戶而滿足履約義務時認列收入。本公司依主要收入項目說明如下：

(1)銷售商品

本公司係於對產品之控制移轉時認列收入。該產品之控制移轉係指產品已交付給客戶，客戶能完全裁決產品之銷售通路及價格，且已無會影響客戶接受該產品之未履行義務。交付係發生於產品運送至特定地點，其陳舊過時及損失風險已移轉予客戶，及客戶已依據銷售合約接受產品，驗收條款已失效，或本公司有客觀證據認為已滿足所有驗收條件時。

本公司於交付商品時認列應收帳款，因本公司在該時點具無條件收取對價之權利。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司依合約估計銷售獎勵之相關退款負債係單獨認列於資產負債表。

(2)財務組成部分

本公司預期所有客戶合約移轉商品予客戶之時間與客戶為該商品付款之時間間隔皆不超過一年，因此，本公司不調整交易價格之貨幣時間價值。

2.客戶合約之成本

(1)取得合約之增額成本

本公司若預期可回收其取得客戶合約之增額成本，係將該等成本認列為資產。取得合約之增額成本係為取得客戶合約所發生且若未取得該合約則不會發生之成本。無論合約是否取得均會發生之取得合約成本係於發生時認列為費用，除非該等成本係無論合約是否已取得均明確可向客戶收取。

本公司採用準則之實務權宜作法，若取得合約之增額成本認列為資產且該資產之攤銷期間為一年以內，係於該增額成本發生時將其認列為費用。

(2)履行合約之成本

履行客戶合約所發生之成本若非屬其他準則範圍內(國際會計準則第2號「存貨」、國際會計準則第16號「不動產、廠房及設備」或國際會計準則第38號「無形資產」)，本公司僅於該等成本與合約或可明確辨認之預期合約直接相關、會產生或強化未來將被用於滿足(或持續滿足)履約義務之資源，且預期可回收時，始將該等成本認列為資產。

一般及管理成本、用以履行合約但未反映於合約價格之浪費之原料、人工或其他資源成本、與已滿足(或已部分滿足)履約義務相關之成本，以及無法區分究係與未滿足履約義務或已滿足(或已部分滿足)履約義務相關之成本，係於發生時認列為費用。

(十四)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供服務期間內認列為損益項下之員工福利費用。

2.確定福利計畫

本公司對確定福利計畫之淨義務係以員工當期或以前期間服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算，並減除計畫資產之公允價值。

確定福利義務每年由合格精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對本公司可能有利時，認列資產係以從該計畫退還提撥金或對該計畫減少未來提撥金之形式可得之任何經濟效益之現值為限。計算經濟效益現值時，係考量任何最低資金提撥要求。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

淨確定福利負債之再衡量數，包含精算損益、計畫資產報酬(不包括利息)，及資產上限影響數之任何變動(不包括利息)係立即認列於其他綜合損益，並累計於保留盈餘。本公司決定淨確定福利負債(資產)之淨利息費用(收入)，係使用年度報導期間開始時所決定之淨確定福利負債(資產)及折現率。確定福利計畫之淨利息費用及其他費用係認列於損益。

計畫修正或縮減時，所產生與前期服務成本或縮減利益或損失相關之福利變動數，係立即認列為損益。本公司於清償發生時，認列確定福利計畫之清償損益。

3.短期員工福利

短期員工福利義務係以未折現之基礎衡量，且於提供相關服務時認列為費用。

有關短期現金紅利或分紅計劃下預期支付之金額，若係因員工過去提供服務而使本公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

(十五)所得稅

所得稅包括當期及遞延所得稅。除直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括依據當年度課稅所得(損失)計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅或應收退稅款之調整。其金額係反映所得稅相關不確定性(若有)後，按報導日之法定稅率或實質性立法之稅率衡量預期將支付或收取款項之最佳估計值。

遞延所得稅係就資產及負債於報導日之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。下列情況產生之暫時性差異不予認列遞延所得稅：

- 1.非屬企業合併之交易原始認列之資產或負債，且於交易當時(i)不影響會計利潤及課稅所得(損失)且(ii)並未產生相等之應課稅及可減除暫時性差異者；
- 2.因投資子公司、關聯企業及合資權益所產生之暫時性差異，本公司可控制暫時性差異迴轉之時點且很有可能於可預見之未來不會迴轉者；以及
- 3.商譽原始認列所產生之應課稅暫時性差異。

對於未使用之課稅損失及未使用所得稅抵減遞轉後期，與可減除暫時性差異，在很有可能未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減；或在變成很有可能足夠課稅所得之範圍內迴轉原已減少之金額。

遞延所得稅係以預期暫時性差異迴轉時之稅率衡量，採用報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎，並已反映所得稅相關不確定性(若有)。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關：
 - (1)同一納稅主體；或
 - (2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

(十六)每股盈餘

本公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。本公司基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。

(十七)部門資訊

本公司已於合併財務報告揭露部門資訊，因此個體財務報告不揭露部門資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層編製本個體財務報告時，必須對未來（包括氣候相關風險及機會）作出判斷及估計，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理階層持續檢視估計及基本假設，其與本公司之風險管理及氣候相關承諾一致，估計值之變動係於變動期間及受影響之未來期間推延認列。

以下假設及估計之不確定性具有導致資產及負債帳面金額於下個財務年度重大調整之重大風險，其相關資訊如下：

(一)應收帳款之備抵損失

應收款項之備抵損失，係以違約風險及預期損失率之假設為基礎估計。本公司於每一報導日考量歷史經驗、目前市場狀況及前瞻性估計，以判斷計算減損時須採用之假設及選擇之輸入值。減損提列情形請詳附註六(三)。

(二)存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低衡量，本公司評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產業快速變遷而產生重大變動。存貨評價估列情形請詳附註六(四)。

(三)採用權益法之投資減損評估

採用權益法之投資之減損評估過程依賴本公司之主觀判斷，包含辨認現金產生單位及決定相關現金產生單位之可回收金額。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	<u>113.12.31</u>	<u>112.12.31</u>
現金及零用金	\$ 163	163
支票及活期存款	401,194	663,288
定期存款	<u>161,253</u>	<u>132,146</u>
	<u>\$ 562,610</u>	<u>795,597</u>

本公司金融資產及負債之利率風險及敏感度分析之揭露請詳附註六(十九)。

(二)金融資產及負債

1.明細如下：

	<u>113.12.31</u>	<u>112.12.31</u>
流 動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產：		
受益憑證	\$ 20,089	20,032
遠期外匯合約	<u>-</u>	<u>1,028</u>
	<u>\$ 20,089</u>	<u>21,060</u>
非 流 動：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產：		
國外基金	\$ <u>66,152</u>	<u>22,383</u>
其他金融資產：		
存出保證金	\$ <u>18,143</u>	<u>51,867</u>
流 動 負 債：		
強制透過損益按公允價值衡量之金融負債：		
遠期外匯合約	\$ <u>859</u>	<u>-</u>

本公司已於附註六(十九)揭露與金融工具相關之信用、貨幣及利率暴險。

2.從事衍生金融工具係因以規避營業活動所暴露之匯率風險，本公司因未適用避險會計列報為強制透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之衍生工具明細如下：

		<u>113.12.31</u>		
		<u>合約金額</u>	<u>幣別</u>	<u>到期期間</u>
賣出/買入遠期外匯	USD	4,000 /NTD 130,278	美元兌台幣	114.01.02
		<u>112.12.31</u>		
		<u>合約金額</u>	<u>幣別</u>	<u>到期期間</u>
賣出/買入遠期外匯	USD	2,000 /NTD 62,482	美元兌台幣	113.01.05

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(三)應收票據及帳款

	<u>113.12.31</u>	<u>112.12.31</u>
應收票據	\$ 12	282
應收帳款	495,566	440,402
減：備抵損失	<u>(4,916)</u>	<u>(4,765)</u>
	<u>\$ 490,662</u>	<u>435,919</u>

本公司針對所有應收票據及應收帳款採用簡化作法估計預期信用損失，亦即使用存續期間預期信用損失衡量，為此衡量目的，該等應收票據及應收帳款係按代表客戶依據合約條款支付所有到期金額能力之共同信用風險特性予以分組，並已納入前瞻性之資訊。

本公司應收票據及應收帳款之預期信用損失分析如下：

	<u>113.12.31</u>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 427,755	0.99%	4,238
逾期1~90天	<u>67,823</u>	1%	<u>678</u>
	<u>\$ 495,578</u>		<u>4,916</u>
	<u>112.12.31</u>		
	<u>應收款項 帳面金額</u>	<u>加權平均預期 信用損失率</u>	<u>備抵存續期間 預期信用損失</u>
未逾期	\$ 422,673	1%	4,225
逾期1~90天	<u>18,011</u>	3%	<u>540</u>
	<u>\$ 440,684</u>		<u>4,765</u>

本公司應收票據及應收帳款之備抵損失變動表如下：

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
期初餘額	\$ 4,765	12,560
本期認列(迴轉)	<u>151</u>	<u>(7,795)</u>
期末餘額	<u>\$ 4,916</u>	<u>4,765</u>

本公司應收票據及應收帳款均未貼現或作為擔保品。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(四)存 貨

	<u>113.12.31</u>	<u>112.12.31</u>
製成品	\$ 500,174	617,798
在製品及半成品	128,247	119,510
原物料	348,935	375,951
委外存貨	90,293	106,995
在途存貨	<u>16,188</u>	<u>4,139</u>
	<u>\$ 1,083,837</u>	<u>1,224,393</u>

民國一一三年度及一一二年度認列為銷貨成本及費用之存貨成本分別為3,707,744千元及3,305,509千元。民國一一三年度及一一二年度因存貨自成本沖減至淨變現價值，或報廢存貨而減少營業成本認列之損(益)分別為(217,754)千元及201,269千元。

截至民國一一三年及一一二年十二月三十一日止，本公司之存貨均未有提供作質押擔保之情形。

(五)採用權益法之投資

1.本公司於報導日採用權益法之投資列示如下：

	<u>113.12.31</u>	<u>112.12.31</u>
子公司：		
Ever Energetic Int'l Ltd. (Ever Energetic)	\$ 1,485,168	1,508,678
Ever Winner Int'l Co., Ltd. (Ever Winner)	1,771,549	1,749,041
Skyrise Int'l Ltd. (Skyrise)	1,943	1,831
Taiwan Semiconductor Europe Gmbh (TSCE)	60,021	71,525
Taiwan Semiconductor Japan Ltd. (TSCJ)	134,922	121,218
Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd. (TSCH)	638,955	617,134
鼎翰科技	<u>1,100,090</u>	<u>1,142,998</u>
	<u>\$ 5,192,648</u>	<u>5,212,425</u>

2.子公司

請參閱民國一一三年度合併財務報告。

民國一一三年度及一一二年度認列採用權益法認列子公司利益之份額各為419,887千元及404,836千元。

本公司於民國九十六年三月轉投資1,000千元設立鼎翰科技，並於民國九十六年八月一日將本公司條碼印表機事業處帳面金額計150,000千元之資產及負債分割讓與鼎翰科技。此外，鼎翰科技歷年陸續辦理現金增資發行新股，本公司因未每次均按原持股比例認購新股，對於鼎翰科技持股比例發生變動，致本公司所投資之股權淨值發生增減，並逐次作為權益交易認列；另，鼎翰科技歷年員工行使認股權發行新股，綜上，截至民國一一三年及一一二年十二月三十一日止本公司對於鼎翰科技持股比例為35.87%及36.05%。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

民國一一三年及一一二年十二月三十一日，本公司對TSCH之持股比例皆為25.22%，Ever Energetic對其之持股比例為36.96%及Ever Winner對其之持股比例為37.82%，故本公司對TSCH之綜合持股比例為100%。

(六)不動產、廠房及設備

本公司不動產、廠房及設備之成本及折舊變動明細如下：

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	辦 公 及 其 他 設 備	總 計
成本或認定成本：					
民國113年1月1日餘額	\$ 636,086	739,113	3,051,327	147,535	4,574,061
增 添	-	3,800	104,799	6,448	115,047
處 分	-	-	(8,847)	(1,948)	(10,795)
報 廢	-	-	(33,299)	(1,282)	(34,581)
其 他(含利息資本化)	-	192	252,557	84	252,833
民國113年12月31日餘額	<u>\$ 636,086</u>	<u>743,105</u>	<u>3,366,537</u>	<u>150,837</u>	<u>4,896,565</u>
民國112年1月1日餘額	\$ 636,086	737,016	2,822,017	132,222	4,327,341
增 添	-	1,967	88,337	14,768	105,072
報 廢	-	-	(5,147)	(1,349)	(6,496)
其 他(含利息資本化)	-	130	146,120	1,894	148,144
民國112年12月31日餘額	<u>\$ 636,086</u>	<u>739,113</u>	<u>3,051,327</u>	<u>147,535</u>	<u>4,574,061</u>
累計折舊：					
民國113年1月1日餘額	\$ -	328,137	2,042,838	114,023	2,484,998
本年度折舊	-	28,125	329,669	11,996	369,790
處 分	-	-	(8,847)	(1,489)	(10,336)
報 廢	-	-	(33,299)	(1,282)	(34,581)
民國113年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>356,262</u>	<u>2,330,361</u>	<u>123,248</u>	<u>2,809,871</u>
民國112年1月1日餘額	\$ -	300,279	1,754,707	103,477	2,158,463
本年度折舊	-	27,858	293,278	11,890	333,026
報 廢	-	-	(5,147)	(1,344)	(6,491)
民國112年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>328,137</u>	<u>2,042,838</u>	<u>114,023</u>	<u>2,484,998</u>
帳面金額：					
民國113年12月31日	<u>\$ 636,086</u>	<u>386,843</u>	<u>1,036,176</u>	<u>27,589</u>	<u>2,086,694</u>
民國112年1月1日	<u>\$ 636,086</u>	<u>436,737</u>	<u>1,067,310</u>	<u>28,745</u>	<u>2,168,878</u>
民國112年12月31日	<u>\$ 636,086</u>	<u>410,976</u>	<u>1,008,489</u>	<u>33,512</u>	<u>2,089,063</u>

本公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日購置固定資產利息費用資本化金額分別為1,558千元及1,206千元，資本化利率皆為1.50%。

截至民國一一三年及一一二年十二月三十一日止，本公司之不動產、廠房及設備均未有提供作質押之情形。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(七)使用權資產

本公司承租房屋及建築之成本及折舊，其變動明細如下：

	<u>房屋及建築</u>
使用權資產成本：	
民國113年12月31日餘額(即期初餘額)	\$ <u>4,876</u>
民國112年1月1日餘額	\$ -
增 添	<u>4,876</u>
民國112年12月31日餘額	\$ <u>4,876</u>
使用權資產之累計折舊：	
民國113年1月1日餘額	\$ 852
提列折舊	<u>1,665</u>
民國113年12月31日餘額	\$ <u>2,517</u>
民國112年1月1日餘額	\$ -
提列折舊	<u>852</u>
民國112年12月31日餘額	\$ <u>852</u>
帳面金額：	
民國113年12月31日	\$ <u>2,359</u>
民國112年1月1日	\$ -
民國112年12月31日	\$ <u>4,024</u>

(八)無形資產

本公司無形資產之成本及攤銷明細如下：

	<u>電腦軟體</u>
成 本：	
民國113年1月1日餘額	\$ 264,871
單獨取得	9,092
本期減少	(150)
其 他(含利息資本化)	<u>10,782</u>
民國113年12月31日餘額	\$ <u>284,595</u>
民國112年1月1日餘額	\$ 205,638
單獨取得	<u>59,233</u>
民國112年12月31日餘額	\$ <u>264,871</u>
累計攤銷：	
民國113年1月1日餘額	\$ 193,106
本期攤銷	35,853
本期減少	<u>(150)</u>
民國113年12月31日餘額	\$ <u>228,809</u>

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	<u>電腦軟體</u>
民國112年1月1日餘額	\$ 141,179
本期攤銷	<u>51,927</u>
民國112年12月31日餘額	<u>\$ 193,106</u>
帳面金額：	
民國113年12月31日	<u>\$ 55,786</u>
民國112年1月1日	<u>\$ 64,459</u>
民國112年12月31日	<u>\$ 71,765</u>

(九)短期借款

	<u>113.12.31</u>	<u>112.12.31</u>
信用借款	\$ 150,000	950,000
進出口貸款	<u>295,065</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 445,065</u>	<u>950,000</u>
尚未使用額度	<u>\$ 3,010,635</u>	<u>1,899,165</u>
借款利率區間(%)	<u>1.80%~5.20%</u>	<u>1.57%~1.60%</u>

本公司開立保證票據予借款銀行，請詳附註九。

(十)長期借款

	<u>113.12.31</u>		
	<u>利率區間</u>	<u>到期年度</u>	<u>金額</u>
無擔保銀行借款	1.675%	119.01.15	\$ 13,660
	1.525%	118.03.15	304,000
	1.525%	118.02.01	92,700
	1.320%	117.12.31	112,190
	1.325%	116.07.16	165,333
	1.325%	115.12.04	43,475
	1.325%	114.03.28	<u>20,000</u>
			751,358
減：一年內到期部分			<u>(106,683)</u>
合計			<u>\$ 644,675</u>
尚未使用額度			<u>\$ 2,614,570</u>

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	112.12.31		
	利率區間	到期年度	金額
無擔保銀行借款	1.20%	116.07.16	\$ 229,334
	1.20%	115.12.04	66,157
	1.20%	114.03.28	100,000
	1.20%	113.12.25	120,000
	1.75%	113.03.08	11,900
			527,391
減：一年內到期部分			(298,583)
合計			<u>\$ 228,808</u>
尚未使用額度			<u>\$ 911,370</u>

本公司為充實中期營運資金，分別與各家銀行簽訂授信合約，並定期支付利息，短期借款於合約到期前，可於融資額度內循環動用；中長期借款不得循環動用。上述借款到期日皆係以借款期間之訖日為揭露基準。

本公司民國一一三年度向金融機構新增無擔保借款為522,550千元，依合約規定寬限期為2~6年。

(十一)租賃負債

本公司租賃負債之帳面金額如下：

	113.12.31
流動	\$ 957
非流動	403
	<u>\$ 1,360</u>

到期分析請詳附註六(十九)金融工具。

認列於損益之金額如下：

	113年度	112年度
租賃負債之利息費用	<u>\$ 31</u>	<u>26</u>
短期租賃之費用	<u>\$ 3,955</u>	<u>3,679</u>
低價值租賃資產之費用(不包含短期租賃之低價值租賃)	<u>\$ 147</u>	<u>218</u>

認列於現金流量表之金額如下：

	113年度	112年度
租賃之現金流出總額	<u>\$ 5,104</u>	<u>4,490</u>

本公司承租房屋及建築作為辦公處所及廠房，租賃期間為三年。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十二)員工福利

1.確定福利計畫

本公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	<u>113.12.31</u>	<u>112.12.31</u>
確定福利義務之現值	\$ (49,982)	(62,438)
計畫資產之公允價值	<u>44,380</u>	<u>39,945</u>
淨確定福利負債	<u>\$ (5,602)</u>	<u>(22,493)</u>

(1)計畫資產組成

本公司之確定福利計畫提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。本公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

截至報導日，本公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計44,380千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動基金局網站公布之資訊。

(2)確定福利義務現值之變動

本公司確定福利義務現值變動如下：

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
1月1日確定福利義務	\$ (62,438)	(60,476)
當期服務成本及利息	(661)	(677)
淨確定福利負債再衡量數		
— 因財務假設變動所產生之精算(損)益	878	(242)
— 因經驗調整所產生之精算損失	(3,039)	(2,706)
計畫支付之福利	<u>15,278</u>	<u>1,663</u>
12月31日確定福利義務	<u>\$ (49,982)</u>	<u>(62,438)</u>

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(3)計畫資產現值之變動

本公司確定福利計畫資產公允價值之變動如下：

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 39,945	40,430
利息收入	650	710
淨確定福利負債再衡量數		
—計畫資產報酬(不含當期利息)	3,489	173
已提撥至計畫之金額	296	295
計畫支付之福利	-	(1,663)
12月31日計畫資產之公允價值	<u>\$ 44,380</u>	<u>39,945</u>

(4)認列為損益之費用

本公司列報為收益之明細如下：

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
當期服務成本	\$ -	-
淨確定福利資產之淨利息	11	(33)
	<u>\$ 11</u>	<u>(33)</u>
	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
營業成本	\$ 3	(9)
推銷費用	1	(3)
管理費用	6	(20)
研究發展費用	1	(1)
	<u>\$ 11</u>	<u>(33)</u>

(5)認列為其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數

本公司累計認列於其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數如下：

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
1月1日累積餘額	\$ (3,592)	(817)
本期(認列)迴轉	1,328	(2,775)
12月31日累積餘額	<u>\$ (2,264)</u>	<u>(3,592)</u>

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(6)精算假設

本公司於報導日用以決定確定福利義務現值之重大精算假設如下：

	113.12.31	112.12.31
折現率	1.625%~2.00%	1.25%~1.625%
未來薪資增加率	2.50 %	2.50 %

本公司預計於民國一一三年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為307千元。

本公司民國一一三年度及一一二年度確定福利計畫之加權平均存續期間分別為5.00年~13.57年及2.00年~14.46年。

(7)敏感度分析

民國一一三年及一一二年十二月三十一日當採用之主要精算假設變動對確定福利義務現值之影響如下：

	對確定福利義務之影響	
	增加0.25%	減少0.25%
113年12月31日		
折現率	\$ (566)	581
未來薪資增加	566	(554)
112年12月31日		
折現率	(637)	656
未來薪資增加率	638	(623)

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨確定福利負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

2.確定提撥計畫

本公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。在此計畫下本公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。

本公司民國一一三年度及一一二年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為21,145千元及20,172千元，已提撥至勞工保險局。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十三)所得稅

1.所得稅費用

(1)本公司所得稅費用明細如下：

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 36,122	157,857
未分配盈餘加徵稅額	5,836	26,405
調整前期之當期所得稅	-	(6,021)
	<u>41,958</u>	<u>178,241</u>
遞延所得稅費用(利益)		
暫時性差異之發生	26,394	(31,992)
所得稅費用	<u>\$ 68,352</u>	<u>146,249</u>

(2)本公司民國一一三年度及一一二年度並無認列於其他綜合損益及權益之所得稅費用。

(3)本公司稅前淨利與所得稅費用之調節如下：

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
稅前淨利	<u>\$ 532,203</u>	<u>864,889</u>
稅前淨利計算之所得稅額	\$ 106,441	172,978
採用權益法認列之利益份額	(42,851)	(46,698)
未分配盈餘加徵稅額	5,836	26,405
其他	(1,074)	(6,436)
合計	<u>\$ 68,352</u>	<u>146,249</u>

2.遞延所得稅資產及負債

(1)未認列遞延所得稅資產

本公司未認列為遞延所得稅資產之項目如下：

	<u>113.12.31</u>	<u>112.12.31</u>
可減除暫時性差異	<u>\$ 7,597</u>	<u>8,401</u>

(2)已認列之遞延所得稅資產及負債

遞延所得稅資產及負債之變動如下：

遞延所得稅資產：

	<u>存貨跌價 損失</u>	<u>備抵 損失</u>	<u>未實現 銷貨毛利</u>	<u>其他</u>	<u>合計</u>
民國113年1月1日	\$ 90,592	247	10,410	9,196	110,445
認列於損益	(43,551)	(247)	50	(6,398)	(50,146)
民國113年12月31日	<u>\$ 47,041</u>	<u>-</u>	<u>10,460</u>	<u>2,798</u>	<u>60,299</u>

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	存貨跌價 損 失	備 抵 損 失	未 實 現 銷貨毛利	其 他	合 計
民國112年1月1日	\$ 50,338	937	13,563	5,758	70,596
認列於損益	40,254	(690)	(3,153)	3,438	39,849
民國112年12月31日	<u>\$ 90,592</u>	<u>247</u>	<u>10,410</u>	<u>9,196</u>	<u>110,445</u>

遞延所得稅負債：

	採用權益法認 列利益之份額	其 他	合 計
民國113年1月1日	\$ (443,839)	(5,634)	(449,473)
認列於損益	26,726	(2,974)	23,752
民國113年12月31日	<u>\$ (417,113)</u>	<u>(8,608)</u>	<u>(425,721)</u>
民國112年1月1日	\$ (436,112)	(5,504)	(441,616)
認列於損益	(7,727)	(130)	(7,857)
民國112年12月31日	<u>\$ (443,839)</u>	<u>(5,634)</u>	<u>(449,473)</u>

- 截至民國一一三年十二月三十一日止，本公司之營利事業所得稅結算申報，業經稅捐稽徵機關核定至民國一一一年度。
- 本公司部份投資國外子公司之盈餘，因國外營運擴充資金所需，長期暫不擬匯回，故依國際會計準則公報第12號「所得稅」A39段規定，將此盈餘財稅差異視為永久性差異處理。

(十四) 權益

1. 股本

本公司民國一〇八年六月十四日經股東會決議於不超過10,000千股，每股面額新台幣10元額度範圍內授權董事會於股東會決議後一年內以私募方式辦理現金增資發行新股，並於民國一〇八年十月三十日董事會決議以每股44.5元之私募價格發行普通股6,741千股，每股面額10元，計299,975千元，以民國一〇八年十一月十八日為增資基準日，相關法定登記程序已辦理完竣。

上述私募普通股及其嗣後無償配發股份之轉讓須依證券交易法第四十三條之八規定辦理，並於私募普通股交付日(民國一〇八年十二月十八日)起滿三年後，先向金融監督管理委員會辦理公開發行後，始得向證券交易所申請上櫃買賣。本公司已補辦公開發行，並於民國一一二年五月十八日申報生效。

本公司於民國一一二年六月十九日經股東會決議，提高額定資本額為9,000,000千元，並於民國一一二年六月三十日完成法定變更程序。截至民國一一三年及一一二年十二月三十一日額定股本皆為9,000,000千元(其中100,000千元係留供發行員工認股權憑證使用)，實收股本皆為2,634,854千元，每股面額均為10元。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

2. 資本公積

	113.12.31	112.12.31
股票發行溢價	\$ 639,859	639,859
可轉換公司債轉換溢價	1,229,442	1,229,442
庫藏股票交易	232,065	200,145
員工認股權發行溢價	24,378	24,378
轉換公司債應付利息補償金	18,674	18,674
員工認股權	1,543	1,543
採權益法認列關聯企業變動數	107,023	95,210
	\$ 2,252,984	2,209,251

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得按股東原有股份之比例以已實現之資本公積發給新股或現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3. 法定盈餘公積

公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

4. 特別盈餘公積

本公司依證券主管機關規定於分派盈餘時，應就當年度發生之股東權益減項自可分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，而帳列股東權益項下之土地重估增值及累積轉換調整數依規定轉入保留盈餘之金額為302,149千元，依金管會規定提列相同數額之特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。截至民國一一三年及一一二年十二月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額皆為302,149千元。

依金管會規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

5.盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，股東股利之發放由董事會擬妥盈餘分配案，經股東會決議後辦理，其中現金股利不得低於股票股利總額之百分之十，但現金股利每股若低於0.2元則不予以發放改以股票股利發放。

本公司分別於民國一一三年六月十九日及一一二年六月十九日經股東常會決議民國一一二年度及一一一年度盈餘分配案，有關分派予股東情形如下：

	112年度		111年度	
	配股率(元)	金額	配股率(元)	金額
分派予普通股業主之股利：				
現金	\$ 2.00	526,971	4.00	1,053,942

6.庫藏股票

本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押，於未轉讓前，並不得享有股東權益。

另，截至民國一一三年及一一二年十二月三十一日止，子公司鼎翰科技持有本公司普通股分別為15,960千股及14,800千股，買回成本分別為599,878千股506,043千元，列於庫藏股票項下。

本公司於民國一一三年度及一一二年度，將子公司鼎翰科技持有本公司普通股所享之股利收入分別為31,920千元及59,200千元，自採用權益法認列子公司利益之份額轉列資本公積-庫藏股票交易項下。

7.其他權益

	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額
民國113年1月1日餘額	\$ (419,530)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	174,852
民國113年12月31日餘額	\$ (244,678)
民國112年1月1日餘額	\$ (359,558)
換算國外營運機構淨資產所產生之兌換差額	(59,972)
民國112年12月31日餘額	\$ (419,530)

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十五)客戶合約之收入

1.收入之細分

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
主要地區市場：		
亞洲	\$ 2,323,739	2,317,121
美洲	447,302	508,412
歐洲	1,401,954	1,725,706
其他	<u>24,011</u>	<u>59,234</u>
	<u>\$ 4,197,006</u>	<u>4,610,473</u>
主要產品線：		
整流器	<u>\$ 4,197,006</u>	<u>4,610,473</u>

2.合約餘額

	<u>113.12.31</u>	<u>112.12.31</u>	<u>112.1.1</u>
應收票據及應收帳款(含關係人)	\$ 1,022,551	883,514	1,301,424
減：備抵損失	<u>(4,916)</u>	<u>(4,765)</u>	<u>(12,560)</u>
合 計	<u>\$ 1,017,635</u>	<u>878,749</u>	<u>1,288,864</u>

應收帳款及帳款及其減損之揭露請詳附註六(三)。

(十六)營業外收益及費損

1.利息收入

本公司之利息收入明細如下：

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
銀行存款利息	<u>\$ 5,476</u>	<u>11,614</u>

2.其他收入

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
關係人其他收入(附註七)	\$ 12,627	15,212
租金收入	-	539
其 他	<u>3,022</u>	<u>3,560</u>
	<u>\$ 15,649</u>	<u>19,311</u>

3.其他利益及損失

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
處分及報廢不動產、廠房及設備利益	\$ 746	99
外幣兌換利益	74,733	32,763
透過損益按公允價值衡量之金融商品利益	9,430	3,169
其 他	<u>(46)</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 84,863</u>	<u>36,031</u>

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

4.財務成本

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
利息費用	\$ (25,040)	(22,702)
減：利息資本化	1,793	1,417
其他財務費用	<u>(1,153)</u>	<u>(1,390)</u>
	<u>\$ (24,400)</u>	<u>(22,675)</u>

(十七)員工及董事酬勞

依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應先提撥至少百分之四，但以不超過百分之十為員工酬勞，並提撥不超過百分之一為董事酬金。

本公司如有以前年度累積虧損，於當年度有獲利須提撥員工酬勞及董事酬勞金之前，應先彌補虧損，其餘額再依前項比例提撥；又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

前項董事酬勞金僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞金分派案，應由董事會決議，並報告股東會。

本公司民國一一三年度及一一二年度員工酬勞估列金額分別為34,336千元及55,799千元，董事酬勞金估列金額分別為5,723千元及9,300千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上本公司章程訂定之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業費用。相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。前述董事會決議分派之員工及董事酬勞金額與本公司民國一一三年度及一一二年度個體財務報告估列金額並無差異。

(十八)每股盈餘

1.基本每股盈餘

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
本期淨利	\$ <u>463,851</u>	<u>718,640</u>
加權平均流通在外股數(千股)	<u>247,525</u>	<u>248,685</u>
基本每股盈餘(元)	<u>\$ 1.87</u>	<u>2.89</u>

2.稀釋每股盈餘

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
計算稀釋每股盈餘之本期淨利	\$ <u>463,851</u>	<u>718,640</u>
加權平均流通在外股數(千股)	247,525	248,685
員工酬勞	<u>795</u>	<u>880</u>
用以計算稀釋每股盈餘之當期流通在外普通股加權平均股數(千股)	<u>248,320</u>	<u>249,565</u>
稀釋每股盈餘(元)	<u>\$ 1.87</u>	<u>2.88</u>

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十九) 金融工具

1. 信用風險

(1) 信用風險最大暴險之金額

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。

(2) 信用風險集中情況

本公司民國一一三年度及一一二年度之收入分別約13%及11%係來自於對單一客戶之銷售。但未有地區信用風險顯著集中之情形。

(3) 應收款項及債券之信用風險

應收票據及應收帳款之信用風險暴險資訊請詳附註六(三)。

2. 流動性風險

下表為金融負債之合約到期日，包含估計利息之影響。

	帳面金額	合 約				
		現金流量	1年	1-2年	2-5年	超過5年
113年12月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 445,065	448,229	448,229	-	-	-
應付帳款(含關係人)	574,084	574,084	574,084	-	-	-
其他應付款項-關係人	43,971	43,971	43,971	-	-	-
租賃負債	1,360	1,376	971	405	-	-
長期借款(含一年內到期)	751,358	779,537	116,840	128,745	533,572	380
衍生金融負債						
遠期外匯合約	859	859	859	-	-	-
	<u>\$ 1,816,697</u>	<u>1,848,056</u>	<u>1,184,954</u>	<u>129,150</u>	<u>533,572</u>	<u>380</u>
112年12月31日						
非衍生金融負債						
短期借款	\$ 950,000	951,550	951,550	-	-	-
應付帳款(含關係人)	566,474	566,474	566,474	-	-	-
其他應付款項-關係人	35,604	35,604	35,604	-	-	-
租賃負債	2,300	2,347	971	971	405	-
長期借款(含一年內到期)	527,391	536,143	303,244	109,161	123,738	-
	<u>\$ 2,081,769</u>	<u>2,092,118</u>	<u>1,857,843</u>	<u>110,132</u>	<u>124,143</u>	<u>-</u>

本公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

3. 匯率風險

(1) 匯率風險之暴險

本公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	113.12.31		112.12.31	
	匯率	台幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美金	\$ 32.785	1,050,850	30.705	1,276,626
歐元	34.14	294,009	33.98	216,012
日幣	0.2099	17,048	0.2172	2,397
人民幣	4.478	421,000	4.327	382,224
韓元	0.0223	<u>2,128</u>	0.0238	<u>702</u>
		<u>\$ 1,785,035</u>		<u>1,877,961</u>
<u>衍生商品</u>				
美金	\$ 32.785	<u>-</u>	30.705	<u>1,028</u>
採權益法之投資：				
美金	\$ 32.785	3,258,660	30.705	3,259,550
歐元	34.14	60,021	33.98	71,525
日幣	0.2099	134,922	0.2172	121,218
港幣	4.222	<u>638,955</u>	3.929	<u>617,134</u>
		<u>\$ 4,092,558</u>		<u>4,069,427</u>
<u>金融負債</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美金	\$ 32.785	492,111	30.705	203,349
歐元	34.14	33,135	33.98	26,031
日幣	0.2099	7,917	0.2172	833
人民幣	4.478	522,960	4.327	481,967
韓元	0.0223	<u>1,908</u>	0.0238	<u>875</u>
		<u>\$ 1,058,031</u>		<u>713,055</u>
<u>衍生商品</u>				
美金	\$ 32.785	<u>859</u>	-	<u>-</u>

(2) 敏感性分析

本公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之金融資產、金融負債及採用權益法之投資，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一一三年及一一二年十二月三十一日當新台幣相對於上表所列外幣貶值或升值3%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一一三年度及一一二年度之稅後淨利將增加或減少115,649千元及125,649千元；兩期分析係採用相同基礎。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(3) 貨幣性項目之兌換損益

由於本公司功能性貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一一三年度及一一二年度外幣兌換損益（含已實現及未實現）分別為74,733千元及32,763千元。

4. 利率分析

本公司之金融資產及金融負債利率暴險於本附註之流動性風險管理中說明。

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於報導日之利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設報導日流通在外之負債金額於整年度皆流通在外。本公司內部向主要管理人員報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少1%，此亦代表管理人員對利率之合理可能變動範圍之評估。

本公司民國一一三年及一一二年十二月三十一日之借款分別為1,196,423千元及1,477,391千元，係屬浮動利率之債務，故市場利率變動將使借款之有效利率隨之改變，而使其未來現金流量產生波動，若市場利率增加1%，將使本公司一年現金流出增加各為11,964千元及14,774千元。

5. 其他價格風險：

如報導日權益證券價格變動(兩期分析係採用相同基礎，且假設其他變動因素不變)，對綜合損益項目之影響如下：

<u>報導日證券價格</u>	113年度		112年度	
	其他綜合損 益稅後金額	稅後損益	其他綜合損 益稅後金額	稅後損益
	上漲1%	\$ -	730	-
下跌1%	\$ -	(730)	-	(379)

6. 公允價值資訊

(1) 金融工具之種類及公允價值

本公司透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債係以重複性為基礎，按公允價值衡量。各種類金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量金融工具之帳面金額為公允價值之合理近似值者，及租賃負債，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

透過損益按公允價值衡量之金 融資產	113.12.31				
	帳面金額	公允價值			合計
		第一級	第二級	第三級	
受益憑證	\$ 20,089	20,089	-	-	20,089
國外基金	66,152	-	-	66,152	66,152
小計	86,241	20,089	-	66,152	86,241

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	113.12.31				
	帳面金額	公允價值			合計
		第一級	第二級	第三級	
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	562,610	-	-	-	-
應收票據及帳款(含關係人)	1,017,635	-	-	-	-
其他應收款	31,252	-	-	-	-
其他金融資產	18,143	-	-	-	-
小計	1,629,640	-	-	-	-
合計	<u>\$ 1,715,881</u>	<u>20,089</u>	<u>-</u>	<u>66,152</u>	<u>86,241</u>
透過損益按公允價值衡量之金融負債					
遠期外匯合約	\$ 859	-	859	-	859
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付帳款(含關係人)	574,084	-	-	-	-
其他應付款項-關係人	43,971	-	-	-	-
租賃負債	1,360	-	-	-	-
銀行借款	1,196,423	-	-	-	-
小計	1,815,838	-	-	-	-
合計	<u>\$ 1,816,697</u>	<u>-</u>	<u>859</u>	<u>-</u>	<u>859</u>
	112.12.31				
	帳面金額	公允價值			合計
		第一級	第二級	第三級	
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
受益憑證	\$ 20,032	20,032	-	-	20,032
遠期外匯合約	1,028	-	1,028	-	1,028
國外基金	22,383	-	-	22,383	22,383
小計	43,443	20,032	1,028	22,383	43,443
按攤銷後成本衡量之金融資產					
現金及約當現金	795,597	-	-	-	-
應收票據及帳款(含關係人)	878,749	-	-	-	-
其他應收款	32,318	-	-	-	-
其他金融資產	51,867	-	-	-	-
小計	1,758,531	-	-	-	-
合計	<u>\$ 1,801,974</u>	<u>20,032</u>	<u>1,028</u>	<u>22,383</u>	<u>43,443</u>
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付帳款(含關係人)	\$ 566,474	-	-	-	-
其他應付款項-關係人	35,604	-	-	-	-
租賃負債	2,300	-	-	-	-
銀行借款	1,477,391	-	-	-	-
小計	2,081,769	-	-	-	-
合計	<u>\$ 2,081,769</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(2)按公允價值衡量金融工具之公允價值

A.非衍生金融工具

金融工具如有活絡市場公開報價時，則以活絡市場之公開報價為公允價值。主要交易所及經判斷為熱門券之中央政府債券櫃台買賣中心公告之市價，皆屬上市（櫃）權益工具及有活絡市場公開報價之債務工具公允價值之基礎。若能及時且經常自交易所、經紀商、承銷商、產業公會、訂價服務機構或主管機關取得金融工具之公開報價，且該價格代表實際且經常發生之公平市場交易者，則該金融工具有活絡市場公開報價。如上述條件並未達成，則該市場視為不活絡。一般而言，買賣價差甚大、買賣價差顯著增加或交易量甚少，皆為不活絡市場之指標。

除上述有活絡市場之金融工具外，其餘金融工具之公允價值係以評價技術或參考交易對手報價取得。透過評價技術所取得之公允價值可參照其他實質上條件及特性相似之金融工具之現時公允價值、現金流量折現法或以其他評價技術，包括以報導日可取得之市場資訊運用模型計算而得(例如櫃買中心參考殖利率曲線、Reuters商業本票利率平均報價)。

B.衍生金融工具

係根據廣為市場使用者所接受之評價模型評價，例如折現法及選擇權定價模型。遠期外匯合約通常係根據目前之遠期匯率評價。

(3)公允價值等級間之移動

本公司於民國一一三年度及一一二年度公允價值衡量評價方式皆無任何層級間之移轉。

(4)第三等級之變動明細表

	<u>透過損益按 公允價值衡量 之金融資產</u>
民國113年1月1日	\$ 22,383
總利益或損失	
認列於損益	9,624
取得	<u>34,145</u>
民國113年12月31日	<u>\$ 66,152</u>
民國112年1月1日	\$ -
總利益或損失	
認列於損益	(1,381)
取得	19,607
重分類	<u>4,157</u>
民國112年12月31日	<u>\$ 22,383</u>

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

上述總利益或損失，係列報於「其他利益及損失」。其中與民國一一三年及一一二年十二月三十一日仍持有之資產相關者如下：

	<u>113年度</u>	<u>112年度</u>
總利益或損失		
認列於損益(列報於「其他利益及損失」)	\$ 9,624	(1,381)

(5)重大不可觀察輸入值(第三等級)之公允價值衡量之量化資訊

本公司公允價值衡量歸類為第三等級主要透過損益按公允價值衡量之金融資產，相關說明請詳附註六(二)。

本公司持有之國外基金投資公允價值歸類為第三等級具單一重大不可觀察輸入值，重大不可觀察輸入值之量化資訊列表如下：

<u>項目</u>	<u>評價技術</u>	<u>重大不可觀察輸入值</u>	<u>重大不可觀察輸入值與公允價值關係</u>
透過損益按公允價值衡量之金融資產-國外基金	淨資產價值法	• 淨資產價值	• 淨資產價值愈高，公允價值愈高

(二十)財務風險管理

1.概要

本公司因金融工具之使用而暴露於下列風險：

- (1)信用風險
- (2)流動性風險
- (3)市場風險

本附註表達本公司上述各項風險之暴險資訊、本公司衡量及管理風險之目標、政策及程序。進一步量化揭露請詳個體財務報告各該附註。

2.風險管理架構

董事會全權負責成立及監督本公司之風險管理架構，以負責發展及控管本公司之風險管理政策。

本公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析本公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及本公司運作之變化。本公司透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

本公司之審計委員會監督管理人員如何監控本公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核本公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助本公司審計委員會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予審計委員會。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

3.信用風險

信用風險係本公司因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而產生財務損失之風險，主要來自於本公司應收客戶之帳款及投資。

(1)應收帳款

本公司已建立授信政策，本公司依該政策在給予標準之付款及運送條件及條款前，須針對每一新客戶個別分析其信用評等。本公司之覆核包含，若可得時之外部評等，及在某些情況下，銀行之照會。採購限額依個別客戶建立，係代表無須經董事會核准之最大未收金額。此限額經定期覆核。未符合本公司基準信用評等之客戶僅得以預收基礎與本公司進行交易。

銷售貨物若具有保留所有權條款，在未付款的情況下本公司可擁有擔保請求權。本公司對應收帳款及其他應收款並未要求擔保品。

(2)投 資

銀行存款、固定收益投資及其他金融工具之信用風險，係由本公司財務部門衡量並監控。由於本公司之交易對象及履約他方均係信用良好之銀行及具投資等級及以上之金融機構、公司組織及政府機關，無重大之履約疑慮，故無重大之信用風險。

(3)保 證

本公司政策規定僅能提供財務保證予完全擁有之子公司。截至民國一一三年及一一二年十二月三十一日止，本公司均無提供任何背書保證。

4.流動性風險

本公司係透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金以支應本公司營運並減輕現金流量波動之影響。本公司管理人員監督銀行融資額度使用狀況並確保借款合同條款之遵循。

銀行借款對本公司而言係一項重要流動性來源。截至民國一一三年及一一二年十二月三十一日止，本公司未動用之銀行融資額度分別為5,625,205千元及2,810,535千元。

5.市場風險

市場風險係指因市價格變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響本公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

本公司為管理市場風險，從事衍生工具交易，並因此產生金融資產及負債。所有交易之執行均遵循風險管理委員會之指引。

(1)匯率風險

匯率風險之暴險請詳附註六(十九)3.(1)。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(2)利率風險

本公司之政策係確保借款利率變動暴險係採固定利率基礎。

(3)其他市價風險

本公司因上市櫃權益證券投資而產生權益價格暴險。該權益投資非持有供交易而係屬策略性投資。本公司並未積極交易該等投資，本公司管理人員藉由持有不同風險投資組合以管理風險。此外，本公司指派特定團隊監督價格風險並評估何時須增加被規避風險之避險部位。

(二十一)資本管理

本公司之資本管理目標係保障繼續經營之能力，以持續提供股東報酬及其他利害關係人利益，並維持最佳資本結構以降低資金成本。

為維持或調整資本結構，本公司可能調整支付予股東之股利、減資退還股東股款、發行新股或出售資產以清償負債。

本公司與同業相同，係以負債資本比率為基礎控管資本。該比率係以淨負債除以資本總額計算。淨負債係資產負債表所列示之負債總額減去現金及約當現金。資本總額係權益之全部組成部分（亦即股本、資本公積、保留盈餘及其他權益）加上淨負債。

民國一一三年度本公司之資本管理策略與民國一一二年度一致，即維持負債資本比率不高於60%，確保能以合理之成本進行融資。民國一一三年及一一二年十二月三十一日之負債資本比率如下：

	<u>113.12.31</u>	<u>112.12.31</u>
負債總額	\$ 2,691,793	2,977,594
減：現金及約當現金	<u>562,610</u>	<u>795,597</u>
淨負債	\$ 2,129,183	2,181,997
權益總額	<u>7,794,354</u>	<u>7,735,395</u>
資本總額	<u>\$ 9,923,537</u>	<u>9,917,392</u>
負債資本比率	<u>21%</u>	<u>22%</u>

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

七、關係人交易

(一) 母公司與最終控制者

本公司即為最終控制者。

(二) 關係人名稱及關係

於本個體財務報告之涵蓋期間內與本公司有交易之關係人及本公司之子公司如下：

關係人名稱	與本公司之關係
Ever Energetic	子公司
Ever Winner	子公司
Skyrise	子公司
TSCE	子公司
TSCJ	子公司
TSCH	子公司
鼎翰科技	子公司
TSC America, Inc. (TSCA)	子公司
上海瀚科國際貿易有限公司(上海瀚科)	子公司
陽信長威電子有限公司(陽信長威)	子公司
天津長威科技有限公司(天津長威)	子公司
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH (TSCAE)	子公司
TSC Auto ID Technology ME, Ltd. FZE (TSCAD)	子公司
TSC Auto ID Technology Spain, S.L. (TSCAS)	子公司
TSC Auto ID (H.K.) Ltd. (TSC HK)	子公司
TSC Auto Technology America Inc. (TSCAA)	子公司
天津國聚科技有限公司(天津國聚)	子公司
鼎貫科技股份有限公司(鼎貫科技)(註)	子公司
Diversified Labeling Solutions, Inc. (DLS)	子公司
Precision Press & Label, Inc. (PPL)	子公司
TSC Auto ID Technology India Private Limited (TSCIN)	子公司
Mosfortico Investments sp. z o.o. (TSCPL)	子公司
MGN sp. z o.o. (MGN)	子公司
Bluebird Inc. (BB)	子公司
Bluebird Latin America S. de R.L. de CV (BBMX)	子公司
Bluebird USA Inc. (BBUS)	子公司
Bluebird India R&D Center Private Ltd. (BBIN)	子公司
Bluebird Germany GmbH (BBDE)	子公司
Bluebird Europe SL (BBES)	子公司

註：該公司已於民國一一三年五月董事會決議解散清算，並向法院聲報清算完結。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(三)與關係人間之重大交易事項

1.銷 售

本公司對關係人之重大銷售金額如下：

帳列項目	關係人類別	113年度	112年度
	子公司：		
銷貨收入	TSCH	\$ 549,647	519,244
	TSCA	373,336	484,009
	上海瀚科	330,800	403,387
	TSCJ	321,405	282,477
	鼎翰科技	104	467
		<u>\$ 1,575,292</u>	<u>1,689,584</u>

本公司對於上述關係人之銷貨價款係採成本加成作為計價基礎。一般銷貨之收款期限係月結30~120天，銷貨予關係人之收款期限，為月結90~120天，必要時並視其資金需求調整；另，本公司與各關係人間進銷貨帳款收付採應收及應付互抵以淨額收付之。

2.進貨及加工費

本公司向關係人進貨金額如下：

	113年度	112年度
子公司：		
陽信長威	\$ 1,694,350	1,511,067
上海瀚科	193,906	198,936
天津長威	229,460	209,840
	<u>\$ 2,117,716</u>	<u>1,919,843</u>

本公司產銷整流器之主要晶片原料係由本公司自製，或經由本公司及天津長威代採購，交由陽信長威進行後段封裝至成品，再由本公司購回。本公司並未認列相關銷貨收入及營業成本。民國一一三年度及一一二年度依上述交易模式將晶片出貨之金額各為1,168,890千元及894,324千元，該應收款係依雙方議定移轉訂價價格計算。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

3.應收關係人款項

本公司對關係人銷貨產生之應收關係人款項明細如下：

帳列項目	關係人類別	113.12.31	112.12.31
	子公司：		
應收帳款	TSCH	\$ 209,623	180,148
	TSCA	147,556	135,498
	上海瀚科	115,357	79,724
	TSCJ	54,429	47,388
	鼎翰科技	8	72
		<u>\$ 526,973</u>	<u>442,830</u>

4.應付關係人款項

本公司對關係人進貨產生之應付關係人款項明細如下：

帳列項目	關係人類別	113.12.31	112.12.31
	子公司：		
應付帳款	陽信長威	\$ 309,826	288,980
	天津長威	13,266	14,255
		<u>\$ 323,092</u>	<u>303,235</u>

5.佣金支出

本公司支付關係人佣金如下：

	113年度	112年度
子公司：		
TSCE	\$ 98,658	109,699
TSCA	6,511	6,759
	<u>\$ 105,169</u>	<u>116,458</u>

本公司經由海外代理銷售子公司仲介產生之外銷收入淨額或經天津長威代陽信長威採購主要晶片原料，依據與各關係人簽訂之佣金合約約定條件，按月計算外銷佣金，於月結後即支付。

本公司支付關係人佣金產生之其他應付關係人款項明細如下：

帳列項目	關係人類別	113.12.31	112.12.31
	子公司：		
其他應付款項－關係人	TSCE	\$ 42,992	33,477
	TSCA	883	2,027
		<u>\$ 43,875</u>	<u>35,504</u>

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

6.其他交易

本公司與關係人間因相互代墊運費及保險費等營業收入及費用，所產生之其他應收款及其他應付款項金額彙整如下：

帳列項目	關係人類別	113.12.31	112.12.31
	子公司：		
其他應收款	TSCA	\$ 6,716	5,168
	TSCH	613	450
	上海瀚科	116	149
		<u>\$ 7,445</u>	<u>5,767</u>
	子公司：		
其他收入	TSCA	\$ 10,686	13,317
	TSCH	1,640	1,525
	上海瀚科	301	370
		<u>\$ 12,627</u>	<u>15,212</u>
	子公司：		
其他應付款項－關係人	TSCH	\$ 96	92
	鼎翰科技	-	8
		<u>\$ 96</u>	<u>100</u>

(四)主要管理人員交易

主要管理人員報酬包括：

	113年度	112年度
短期員工福利	\$ 87,766	111,950
退職後福利	1,550	1,722
	<u>\$ 89,316</u>	<u>113,672</u>

八、質押之資產：無。

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

本公司向銀行融資及開立融資額度而提供之保證票據明細如下：

	113.12.31	112.12.31
新台幣	\$ 2,370,000	2,081,900
美金	22,300	14,000

截至民國一一三年及一一二年十二月三十一日止，本公司無已開立信用狀尚未使用餘額。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

十二、其他

員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	113年度			112年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	309,806	265,893	575,699	274,291	277,259	551,550
勞健保費用	29,721	19,666	49,387	29,394	19,612	49,006
退休金費用	13,757	7,399	21,156	13,161	6,978	20,139
董事酬金	-	7,383	7,383	-	10,620	10,620
其他員工福利費用	20,615	5,986	26,601	16,451	4,903	21,354
折舊費用	349,867	21,588	371,455	315,213	18,665	333,878
攤銷費用	13,718	22,135	35,853	13,388	38,539	51,927

本公司民國一一三年度及一一二年度員工人數及員工福利費用額外資訊如下：

	113年度	112年度
平均員工人數	<u>645</u>	<u>638</u>
未兼任員工之董事人數	<u>7</u>	<u>5</u>
平均員工福利費用	\$ <u>1,055</u>	\$ <u>1,014</u>
平均員工薪資費用	\$ <u>902</u>	\$ <u>871</u>
平均員工薪資費用調整情形	<u>3.56 %</u>	<u>(16.25)%</u>
監察人酬金	\$ <u>-</u>	\$ <u>-</u>

本公司薪資報酬政策(包括董事、經理人及員工)資訊如下：

(一)董事及經理人：

本公司業已成立薪資報酬委員會並訂定『薪資報酬委員會組織規程』。薪資報酬委員會依相關規程，以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。以善良管理人之注意，忠實履行職權，將所提建議提交董事會討論。並定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，依據績效評估標準所得之評估結果，訂定薪資報酬之內容及數額並提報股東會。

(二)員工：

本公司透過建立客觀的薪酬制度，對外吸引優秀人才，對內具公平性及成長性。並將員工績效考核制度、薪酬與獎勵制度等與企業社會責任政策結合，設立明確有效之獎勵與懲戒制度。公司章程並訂定員工酬勞，每年依據員工之績效考核分配公司利潤，使員工薪資與公司營運共同成長，另對員工舉辦教育訓練與宣導，使其充分了解公司相關薪資報酬政策。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一一年度本公司依編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

1. 資金貸與他人：

單位：新台幣千元

編號 (註1)	貸出資金 之公司	貸與 對象	往來 科目	是否 為關 係人	本期最 高金額 (註5)	期末 餘額	實際動 支金額	利率 區間	資金貸 與性質 (註2)	業務 往來 金額	有短期融 通資金必 要之原因	提列備 抵呆帳 金額	擔保品		對個別對象 資金貸與 限額(註3)	資金貸 與限額 (註4)
													名稱	價值		
1	鼎翰科技	TSCPL(註6)	其他應 收款-關 係人	是	177,600	-	-	- %	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,159	2,010,317
1	鼎翰科技	TSCAE	其他應 收款-關 係人	是	35,520	34,140	10,242	5.00 %	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,159	2,010,317
1	鼎翰科技	TSCAE	其他應 收款-關 係人	是	177,600	170,700	102,420	5.00 %	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,159	2,010,317
1	鼎翰科技	MGN	其他應 收款-關 係人	是	177,600	170,700	123,416	5.00 %	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,159	2,010,317
1	鼎翰科技	MGN	其他應 收款-關 係人	是	213,120	204,840	-	5.00 %	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,159	2,010,317
2	BB	BBDE	其他應 收款-關 係人	是	3,552	3,414	1,707	4.60 %	2	-	營運周轉	1,707	無	-	1,005,159	2,010,317
2	BB	BBDE	其他應 收款-關 係人	是	3,552	3,414	3,414	4.60 %	2	-	營運周轉	3,414	無	-	1,005,159	2,010,317
2	BB	BBES	其他應 收款-關 係人	是	213	205	205	4.60 %	2	-	營運周轉	205	無	-	1,005,159	2,010,317
3	DLS	鼎翰科技	其他應 收款-關 係人	是	98,505	98,355	65,570	6.00 %	2	-	營運周轉	-	無	-	1,005,159	2,010,317

註1：(1)本公司填0。

(2)子公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：編號2係指有短期融通資金之必要者。

註3：鼎翰科技與有短期融通資金性質之必要者或鼎翰科技直接持有表決權股份100%之國外公司對其從事資金貸與，個別對象貸與金額以不超過鼎翰科技淨值20%為限。

註4：鼎翰科技資金貸與他人或鼎翰科技直接持有表決權股份100%之國外公司對其從事資金貸與，其資金貸與他人之總額以不超過鼎翰科技淨額40%為限。

註5：係按民國一一年七月三十一日美金匯率32.835及歐元匯率35.52換算台幣表達。

註6：鼎翰科技對子公司TSCPL之資金貸與額度已於民國一一年三月十五日期限屆滿失效。

2. 為他人背書保證：

單位：新台幣千元

編號 (註1)	背書保 證者公 司名稱	被背書保證對象		對單一企 業背書保 證限額(註3)	本期最高 背書保證 餘額(註5)	期末背 書保證 餘額	實際 動支 金額	以財產擔 保之背書 保證金額	累計背書保證金 額佔最近期財務 報表淨值之比率	背書保 證最高 限額(註4)	屬母公司 對子公司 背書保證	屬子公司 對母公司 背書保證	屬對大陸 地區背書 保證
		公司名稱	關係 (註2)										
1	鼎翰科技	TSCAA	2	2,010,317	197,010	196,710	-	-	3.92 %	3,015,476	Y	N	N
1	鼎翰科技	TSCAE(註6)	2	2,010,317	16,418	-	-	-	- %	3,015,476	Y	N	N

註1：(1)本公司填0。

(2)子公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：編號2係指直接及間接持有表決權之股份超過50%之公司。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

註3：鼎翰科技對單一企業背書保證限額以不超過鼎翰科技淨值40%為限。

註4：鼎翰科技背書保證限額以不超過鼎翰科技淨值60%為限。

註5：係按民國一十三年七月三十一日美金匯率32.835換算台幣表達。

註6：鼎翰科技已於民國一十三年六月十八日通過董事會解除全數對子公司TSCAE之背書保證額度。

3. 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資權益部分)：

單位：新台幣千元

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比例	公允價值	
本公司	富蘭克林華美貨幣市場基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	1,863	20,089	-	20,089	
本公司	Applied WirelessIdentifications Group, Inc.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	243	-	-	-	
本公司	Third Dimension (3D)Semiconductor, Inc.	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	922	-	-	-	
本公司	Achi Capital Partners Fund LP	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	-	66,152	-	66,152	

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元/千股

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期 初		買 入		賣 出				其他(註1)	期 末	
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分損益		金額	股數
鼎翰科技	Bluebird Inc.	採權益法之投資	H-ALPHA PRIVATE EQUITY FUND、JANG WON LEE、CHOI CHAN SIK、UM TAE HOON及HAN SOO HEE	子公司	-	-	6,777	2,783,490	-	-	-	-	(69,049)	6,777	2,714,441

註1：係包含認列國外營運機構財務報表換算之兌換差額(118,918)千元、確定福利計劃精算損失(12,637)千元及投資利益62,506千元。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。

7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：新台幣千元

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間(註1)	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	TSCJ	子公司	銷貨	(321,405)	(8) %		-		54,429	5 %	
本公司	TSCH	子公司	銷貨	(549,647)	(13) %		-		209,623	21 %	
本公司	TSCA	孫公司	銷貨	(373,336)	(9) %		-		147,556	14 %	
本公司	上海瀚科	孫公司	銷貨	(330,800)	(8) %		-		115,357	11 %	註2
本公司	上海瀚科	孫公司	進貨	193,906	7 %		-		-	- %	
本公司	陽信長威	孫公司	進貨	1,694,350	59 %		-		(309,826)	(54) %	註2
本公司	天津長威	孫公司	進貨	229,460	8 %		-		(13,266)	(2) %	

註1：月結90~120天，必要時視其資金需求調整之。

註2：應收付帳款係以淨額列示。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額(註1)	提列備抵呆帳金額
					金額	處理方式		
本公司	TSCH	子公司	209,623	2.82 %	-		132,201	-
本公司	TSCA	孫公司	147,556	2.64 %	-		52,543	-
本公司	上海瀚科	孫公司	115,357	2.81 %	-		70,045	-

註1：截至查核報告日止。

9.從事衍生工具交易：請詳附註六(二)。

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一一三年度本公司之轉投資事業資訊如下：

單位：新台幣千元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益(註1)	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	Ever Energetic	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	665,501	665,501	21,175	100.00 %	1,485,168	(11,051)	(11,051)	子公司
本公司	Ever Winner	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	465,127	465,127	16,010	100.00 %	1,771,549	233,318	233,318	子公司
本公司	Skyrise	英屬維京群島	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	2,845	2,845	50	100.00 %	1,943	(12)	(12)	子公司
本公司	TSCE	德國	一般進出口業務	10,972	10,972	-	100.00 %	60,021	(12,043)	(12,043)	子公司
本公司	TSCJ	日本	整流器之買賣業務	28,689	28,689	2	100.00 %	134,922	18,007	18,007	子公司
本公司	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	282,312	282,312	672	25.22 %	638,955	71,223	(17,566)	子公司
本公司	鼎輪科技	台灣	條碼印表機之製造及買賣	163,728	163,728	16,995	35.87 %	1,100,090	669,957	209,234	子公司
Ever Energetic	TSCA	美國	整流器之買賣業務	258,520	258,520	6,750	75.00 %	212,988	(49,715)	(37,286)	子公司
Ever Energetic	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	571,628	571,628	985	36.96 %	1,224,865	71,223	26,324	子公司
Ever Winner	TSCA	美國	整流器之買賣業務	83,813	83,813	2,250	25.00 %	70,996	(49,715)	(12,429)	子公司
Ever Winner	上海瀚科	中國大陸	整流器之買賣業務	4,461	4,461	-	100.00 %	384,945	218,871	218,871	子公司
Ever Winner	TSCH	香港	對各種生產事業之投資及整流器之買賣業務	792,254	792,254	1,008	37.82 %	1,253,366	71,223	26,937	子公司
TSCH	陽信長威	中國大陸	整流器之製造及買賣業務	966,119	966,119	-	100.00 %	2,398,860	56,279	56,279	子公司
TSCH	天津長威	中國大陸	晶片之製造及買賣業務	787,044	787,044	-	100.00 %	644,890	(15,717)	(15,717)	子公司
鼎輪科技	TSCAE	德國	條碼印表機及其零件之銷售	2,943	2,943	註2	100.00 %	(35,864)	151	151	子公司

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益(註1)	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
鼎翰科技	TSCAA	美國	條碼印表機及其零件之銷售	1,096,621	1,096,621	16,000	100.00 %	1,130,227	15,317	15,317	子公司
鼎翰科技	TSC HK	香港	對各種生產事業之投資及一般進出口業務	47,468	47,468	12,711	100.00 %	848,660	121,221	121,221	子公司
鼎翰科技	鼎貫科技(註5)	台灣	條碼印表機及其零件之銷售	-	5,000	-	- %	-	(162)	(162)	子公司
鼎翰科技	DLS	美國	印表機週邊耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	801,558	801,558	1	100.00 %	1,534,114	87,349	87,349	子公司
鼎翰科技	TSCIN	印度	條碼印表機及其零件之銷售	2,791	2,791	710	100.00 %	1,850	615	615	子公司
鼎翰科技	TSCPL	波蘭	一般投資	498,827	498,827	註3	100.00 %	471,032	(36,981)	(36,981)	子公司
鼎翰科技	BB	韓國	經營企業用手持電腦及其零件產銷	2,783,490	-	6,777	96.54 %	2,714,441	87,189	62,506	子公司
鼎翰科技	BBMX	墨西哥	經營企業用手持電腦及其零件產銷	註4	-	註2	0.03 %	1	2,682	1	子公司
TSCAE	TSCAD	阿拉伯聯合大公國	條碼印表機及其零件之銷售	8,234	8,234	註2	100.00 %	(15,436)	(1,382)	(1,382)	子公司
TSCAE	TSCAS	西班牙	條碼印表機及其零件之銷售	124	124	註2	100.00 %	3,252	244	244	子公司
DLS	PPL	美國	印表機各式標籤紙及其耗材之銷售	115 (千美元)	115 (千美元)	850	100.00 %	50,916	9,375	9,375	子公司
TSCPL	MGN	波蘭	印表機耗材及各式標籤紙之客製化設計、整合及產銷	71,613 (千波蘭幣)	71,613 (千波蘭幣)	2	100.00 %	549,383	(8,801)	(15,703)	子公司
TSC HK	天津國聚	中國大陸	條碼印表機及其零件之產銷	49,178	49,178	-	100.00 %	887,521	130,982	130,982	子公司
BB	BBMX	墨西哥	經營企業用手持電腦及其零件產銷	5	-	註2	99.97 %	5	2,682	2,682	子公司
BB	BBUS	美國	經營企業用手持電腦及其零件產銷	2,920	-	註3	100.00 %	-	(73)	(73)	子公司
BB	BBIN	印度	研發及設計企業用手持電腦、技術服務	4,078	-	990	99.00 %	5,279	1,846	1,827	子公司
BB	BBDE	德國	經營企業用手持電腦及其零件產銷	756	-	註2	100.00 %	-	(1,918)	(1,918)	子公司
BB	BBES	西班牙	經營企業用手持電腦及其零件產銷	1,265	-	註2	100.00 %	1,121	(27)	(27)	子公司

註1：係依據被投資公司經會計師查核財務報告之財務報告認列。

註2：其公司執照上僅表彰其投資金額，並無股數之記載。

註3：持有股數未滿仟股，故未列示。

註4：金額未滿千元，故未列示。

註5：該公司已於民國一三年五月董事會決議解散清算，並向法院聲報清算完結。

台灣半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(三)大陸投資資訊：

1.大陸被投資公司名稱、主要營業項目等相關資訊：

單位：新台幣千元

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項目	實收 資本額	投資 方式 (註1)	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資 公司 本期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認 列投資 損益	期末投 資帳面 價值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回						
上海瀚科	整流器之買賣 業務	4,461	(二)	4,461	-	-	4,461	218,871	100.00 %	218,871	384,945	611,860
陽信長威	整流器之製造 及買賣業務	1,677,160	(二)	628,196	-	-	628,196	56,279	100.00 %	56,279	2,398,860	250,864
天津長威	晶片之製造及 買賣業務	387,173	(二)	387,173	-	-	387,173	(15,717)	100.00 %	(15,717)	644,890	452,102
天津國聚	條碼印表機及 其零件之產銷	47,019	(二)	49,178	-	-	49,178	130,982	35.87 %	46,983	887,521	886,152

註1：編號(二)係指透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

2.赴大陸地區投資限額：

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准 投資金額	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
1,098,947	2,174,242	4,676,612

註：本公司所投資Achi Capital Partners Fund LP基金，因其轉投資大陸地區，使本公司增加投審會核准額度USD107千元。另有新增投資14,518千元(美金443千元)已匯出尚在經濟部投資審議司核備中。

3.重大交易事項：

本公司民國度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

(四)主要股東資訊：

單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
鼎翰科技股份有限公司		15,960,000	6.05 %

註：(1)本表主要股東資訊係由集保公司以每季最後一個營業日，計算股東持有公司已完成無實體登錄交付(含庫藏股)之普通股及特別股合計達百分之五以上資料。至於公司財務報告所記載股本與公司實際已完成無實體登錄交付股數，可能因編製計算基礎不同或有差異。

(2)上開資料如屬股東將持股交付信託，係以受託人開立信託專戶之委託人個別分戶揭示。至於股東依據證券交易法令辦理持股超過百分之十之內部人股權申報，其持股包括本人持股加計其交付信託且對信託財產具有運用決定權股份等，有關內部人股權申報資料請參閱公開資訊觀測站。

十四、部門資訊

營運部門資訊請詳民國一一三年度合併財務報告。

台灣半導體股份有限公司

現金及約當現金明細表

民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	摘 要	金 額
現金及零用金		\$ 163
支票及活期存款		66,776
外幣存款		
	美金5,064千元，匯率32.785	\$ 166,015
	歐元4,400千元，匯率34.14	150,228
	日幣81,215千元，匯率0.2099	17,047
	人民幣117千元，匯率4.478	525
	韓元27,067千元，匯率0.0223	<u>603</u>
定期存款		334,418
	人民幣36,010千元，匯率4.478	161,253
	利率區間為2.40%~2.58%	
	一年內到期	
合 計		<u>\$ 562,610</u>

台灣半導體股份有限公司
 透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動明細表
 民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

金融工具名稱	摘要 (付息還本日)	千股數 或張數	面 值	總 額 (名目本金)	利率 (%)	取得成本	公允價值		備 註
							單價(元)	總 額	
國內外未上市股票：									
Applied Wireless Identifications Group, Inc.		243	\$ -	-	-	14,259	-	-	無提供擔保或質押
Third Dimension (3D) Semiconductor, Inc.		921	-	-	-	956	-	-	"
小 計						15,215		-	
受益憑證：									
富蘭克林華美貨幣市場基金		1,863	-	-	-	20,000	10.78	20,089	"
合 計						\$ 35,215		20,089	

台灣半導體股份有限公司

應收票據明細表

民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

<u>客戶名稱</u>	<u>摘 要</u>	<u>金 額</u>
A公司	營業收入	\$ <u>12</u>

應收帳款明細表

民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

<u>客戶名稱</u>	<u>摘 要</u>	<u>金 額</u>
B公司	營業收入	\$ 58,677
C公司	"	31,319
D公司	"	26,675
其 他(註)	"	<u>378,895</u>
		495,566
減：備抵損失		<u>(4,916)</u>
合 計		<u>\$ 490,650</u>

註：各戶餘額未超過本項目金額5%者，不予單獨列示。

台灣半導體股份有限公司

其他應收款明細表

民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	金 額
應退營業稅款	\$ 15,155
其 他(註)	16,097
合 計	<u>\$ 31,252</u>

註：各戶餘額未超過本項目金額5%者，不予單獨列示。

存貨明細表

民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	金 額		備 註
	成 本	市 價	
製成品	\$ 668,262	602,087	市價採淨變現價值
在製品及半成品	179,580	175,627	市價採淨變現價值
原 物 料	364,720	372,243	市價採重置成本及淨變現價值
委外存貨	90,293	90,293	取得成本
在途存貨	16,188	16,188	取得成本
減：備抵跌價損失	(235,206)	-	
小 計	<u>\$ 1,083,837</u>	<u>1,256,438</u>	

台灣半導體股份有限公司
其他流動資產明細表
民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	摘 要	金 額
預付貨款		\$ 42,636
預付費用		14,484
用品盤存	維修備品等	9,397
其 他(註)		7,769
合 計		\$ 74,286

註：各戶餘額未達本項目金額5%者，不予單獨列示。

透過損益按公允價值衡量之金融資產
—非流動變動明細表

民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

金融工具名稱	期 初		本 期 增 加		其 他(註1)		期 末		提供擔保 或質押情形
	股 數 或張數	公 允 價 值	股 數 或張數	金 額	股 數 或張數	金 額	股 數 或張數	公 允 價 值	
Achi Capital Partners Fund LP	-	\$ 22,383	-	34,145	-	9,624	-	66,152	無

註1：其他係自透過損益按公允價值衡量之金融商品利益。

台灣半導體股份有限公司

採用權益法之投資變動明細表

民國一十三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

被投資公司	期初餘額		本期增加		本期減少		其他異動(註1)		期末餘額			提供擔保 或質押情形	
	股數	金額	股數	金額	股數	金額	股數	金額	股數	持股比例	金額		股權淨值
Ever Energetic Int'l Ltd.	21,175	\$ 1,508,678	-	-	-	-	-	(23,510)	21,175	100.00	1,485,168	1,511,477	無
Ever Winner Int'l Co., Ltd.	16,010	1,749,041	-	-	-	-	-	22,508	16,010	100.00	1,771,549	1,783,972	"
Skyrise Int'l Ltd.	50	1,831	-	-	-	-	-	112	50	100.00	1,943	1,943	"
Taiwan Semiconductor Europe GmbH	-	71,525	-	-	-	-	-	(11,504)	-	100.00	60,021	60,021	"
Taiwan Semiconductor Japan Ltd.	2	121,218	-	-	-	-	-	13,704	2	100.00	134,922	134,922	"
Taiwan Semiconductor (H.K.) Co., Ltd.	672	617,134	-	-	-	-	-	21,821	672	25.22	638,955	650,677	"
鼎翰科技股份有限公司	16,995	1,142,998	-	-	-	-	-	(42,908)	16,995	35.87	1,100,090	1,709,908	"
合計		<u>\$ 5,212,425</u>		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>(19,777)</u>			<u>5,192,648</u>		

註1：其他異動包括採用權益法認列子公司利益之份額419,887千元、採用權益法認列子公司之其他綜合損益份額(3,999)千元、子公司買回本公司庫藏股(93,835)千元、發放現金股利予子公司31,920千元、國外營運機構財務報表換算之兌換差額貸餘174,852千元、獲配被投資公司現金股利(560,165)千元、對被投資公司未按持股比例變動影響數11,813千元及順流交易未實現利益(250)千元。

台灣半導體股份有限公司
不動產、廠房及設備變動明細表
民國一一三年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣千元

相關資訊請參閱附註六(六)。

使用權資產變動明細表
民國一一三年及一一二年十二月三十一日 單位：新台幣千元

相關資訊請參閱附註六(七)。

無形資產變動明細表
民國一一三年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣千元

相關資訊請參閱附註六(八)。

遞延所得稅資產明細表
民國一一三年十二月三十一日 單位：新台幣千元

相關資訊請參閱附註六(十三)。

台灣半導體股份有限公司
其他金融資產－非流動明細表
民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

相關資訊請參閱附註六(二)。

其他非流動資產明細表
民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	金 額
預付設備款	\$ 99,546
其 他(註)	<u>25,127</u>
合 計	<u><u>\$ 124,673</u></u>

註：各戶餘額未超過本項目金額5%者，不予單獨列示。

短期借款明細表
民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

借款性質	債權人	期 限	利率區間	融資額度	期末餘額	擔保品
信用借款	金融機構	一年內	1.80%~1.90%	\$ 2,800,000	150,000	無
進出口貸款	"	"	4.80%~5.20%	655,700	<u>295,065</u>	"
					<u><u>\$ 445,065</u></u>	

台灣半導體股份有限公司

透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動明細表

民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

金融工具名稱	摘要(付息還本日)	股數或 張數	面值	總額(名日本金)	利率	公允價值		備註
						單價	總額	
遠期外匯合約	114.01.02	-	\$ -	USD 4,000千元	-	-	\$ <u>859</u>	無提供擔保或質押

台灣半導體股份有限公司

應付帳款明細表

民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

供應商名稱	摘要	金額
E公司	進貨	\$ 32,573
F公司	"	24,086
G公司	"	19,572
H公司	"	15,380
其他(註)	"	159,381
合計		<u>\$ 250,992</u>

註：各戶餘額均未超過本項目金額5%，不予單獨列示。

長期借款明細表

民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

債權人	摘要	借款金額	契約期限	利率	抵押或擔保
彰化銀行	信用借款	\$ 13,660	113.02.01~119.01.15，按月付息，自116.02.15起分36期還本	1.675%	無
元大商業銀行	信用借款	304,000	113.03.18~118.03.15，按月付息，自116.04.15起分36期還本	1.525%	"
中國信託商業銀行	信用借款	92,700	113.02.01~118.02.01，按月付息，自116.02.15起分24期還本	1.525%	"
台北富邦銀行	信用借款	112,190	113.02.16~117.12.31，按月付息，自115.02.15起分35期還本	1.320%	"
華南銀行	信用借款	165,333	109.07.16~116.07.16，按月付息，自112.08.15起分48期還本	1.325%	"
華南銀行	信用借款	43,475	108.12.04~115.12.04，按月付息，自111.12.15起分48期還本	1.325%	"
中國信託商業銀行	信用借款	20,000	109.03.30~114.03.28，按月付息，自112.04.15起分24期還本	1.325%	"
		751,358			
減：一年內到期部分		106,683			
合計		<u>\$ 644,675</u>			

台灣半導體股份有限公司

租賃負債明細表

民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項目	租賃期間	折現率	期末餘額
房屋及建築	112.6.1~115.5.31	1.75%	\$ 1,360
減：租賃負債—流動			(957)
租賃負債—非流動			<u>\$ 403</u>

其他流動負債明細表

民國一一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

項目	摘要	金額
應付薪資		\$ 160,761
應付費用	係各項營業費用產生之應付款項	97,569
應付設備款	係待取得採購發票之應付款項	37,705
其他(註)		34,601
合計		<u>\$ 330,636</u>

註：各戶餘額未超過本項目金額5%者，不予單獨列示。

營業收入明細表

民國一一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項目	銷售數量	金額
整流器	4,824,344KPCS	\$ 4,293,336
其他(註)		2,217
減：銷貨退回及折讓		(98,547)
合計		<u>\$ 4,197,006</u>

註：各戶餘額未超過本項目金額5%者，不予單獨列示

台灣半導體股份有限公司

營業成本明細表

民國一一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	金 額
直接原料	
期初原物料	\$ 388,845
期初委外存貨	106,995
加：本期進料	754,304
在製品及製成品轉入	655,015
減：期末原物料	(364,720)
期末委外存貨	(90,293)
轉列營業費用及其他	(39,014)
本期原料耗用	1,411,132
直接人工	108,709
製造費用	1,018,554
製造成本	2,538,395
加：期初在製品及半成品	158,042
購入半成品	1,779
委外加工費用	253,583
成品轉入	143,766
減：期末在製品及半成品	(179,580)
轉原料及物料	(624,901)
其 他	(3,163)
製成品成本	2,287,921
加：期初製成品(含在途存貨4,139千元)	1,023,471
購入製成品	2,118,464
減：期末製成品(含在途存貨16,175千元)	(684,437)
轉原料及在製品	(173,880)
轉列營業費用及其他	(29,160)
轉列報廢損失	(461,599)
代買轉出(晶片)	(814,519)
其 他	21,985
製成品產銷成本	3,244,276
加：存貨報廢損失	461,599
出售原料成本	12,209
減：出售下腳收入	(10,535)
存貨跌價回升利益	(217,754)
營業成本	<u>\$ 3,489,795</u>

台灣半導體股份有限公司

推銷費用明細表

民國一一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

<u>項 目</u>	<u>金 額</u>
薪資支出	\$ 113,599
佣金支出	106,750
出口費用	53,032
其 他(註)	<u>78,477</u>
合 計	<u>\$ 351,858</u>

註：各戶餘額均未超過本項目金額5%，不予單獨列示。

管理費用明細表

民國一一三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

<u>項 目</u>	<u>金 額</u>
薪資支出	\$ 113,083
勞 務 費	15,724
各項攤提	14,096
其 他(註)	<u>55,151</u>
合 計	<u>\$ 198,054</u>

註：各戶餘額均未超過本項目金額5%，不予單獨列示。

社團法人台北市會計師公會會員印鑑證明書

北市財證字第 1141779 號

會員姓名：(1) 郭仰倫
(2) 蕭佩如

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

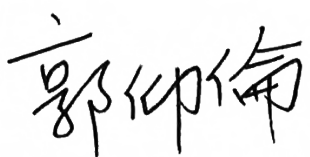
事務所地址：台北市信義區信義路五段7號68樓 事務所統一編號：04016004

事務所電話：(02)81016666 委託人統一編號：34286449

會員書字號：(1) 北市會證字第 4498 號
(2) 北市會證字第 3787 號

印鑑證明書用途：辦理 台灣半導體股份有限公司

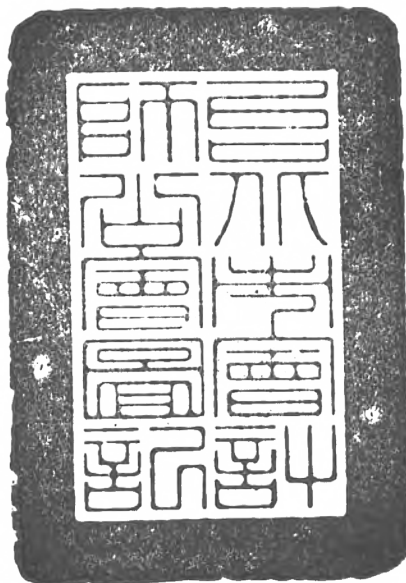
113 年 01 月 01 日 至
113 年度 (自民國 113 年 12 月 31 日) 財務報表之查核簽證。

簽名式 (一)		存會印鑑 (一)	
簽名式 (二)		存會印鑑 (二)	

理事長：



核對人：



中華民國 114 年 03 月 04 日